

MPI CORPORATION

股票代號：6223

旺矽科技股份有限公司

MPI Corporation

114 年度年報

刊印日期：中華民國一一五年五月二十九日

公司網址：<http://www.mpi.com.tw>

本年報查詢網址/公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

一、公司發言人、代理發言人：

發言人姓名：邱靖斐
職稱：董事長特別助理
電話：03-5551771
電子郵件信箱：amanda.chiu@mpi.com.tw

代理發言人姓名：莊潔志
職稱：業務處副處長
電話：03-5551771
電子郵件信箱：raymond.chuang@mpi.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新竹縣竹北市中和街 151 號、153 號、155 號
電 話：03-5551771
竹北二廠：新竹縣竹北市中和街 129 號
電 話：03-5551771
竹北三廠：新竹縣竹北市泰和路 155 號
電 話：03-5551771
新 埔 廠：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 988 號
電 話：03-5551771
湖 口 廠：新竹縣湖口鄉光復路 42 號 B 棟 1F
電 話：03-5551771
南部分公司：高雄市路竹區路科一路 7 號
電 話：07-9559966

三、股票過戶機構：

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司
地址：台北市民生東路四段 54 號 4 樓
網址：<http://www.entrust.com.tw>
電話：02-27186425

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：巫貴珍會計師、陳燦煌會計師
事務所名稱：日正聯合會計師事務所
地址：台北市復興北路 33 號 2 樓
網址：<http://nexia.otc.gs>
電話：02-27510306

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：不適用

六、公司網址：<http://www.mpi.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	49
五、更換會計師資訊.....	50
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	50
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形.....	50
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊.....	52
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	53
參、募集情形.....	54
一、資本及股份.....	54
二、公司債辦理情形.....	58
三、特別股辦理情形.....	58
四、海外存託憑證辦理情形.....	58
五、員工認股權憑證辦理情形.....	58
六、限制員工權利新股辦理情形.....	58
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	58
八、資金運用計畫執行情形.....	58
肆、營運概況.....	59
一、業務內容.....	59
二、市場及產銷概況.....	70
三、從業員工資料.....	75
四、環保支出資訊.....	75
五、勞資關係.....	76
六、資通安全管理.....	80
七、重要契約.....	81
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	83
一、財務狀況.....	83
二、財務績效.....	84
三、現金流量.....	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	86

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	86
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項.....	86
七、其他重要事項.....	89
陸、特別記載事項.....	90
一、關係企業相關資料.....	90
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	95
三、其他必要補充說明事項.....	95
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	95

壹、致股東報告書

一、一一四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本集團民國 114 年合併營業收入淨額為新台幣 133.71 億元，較 113 年的 101.72 億元增加 31%；114 年盈餘為新台幣 31.77 億元，較 113 年盈餘 23.01 億元增加 38%，每股稅後盈餘為 33.49 元，亦較 113 年 24.42 元大幅成長。

近年來，在人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求快速成長的帶動下，全球半導體產業正進入新一輪結構性成長周期。隨著雲端資料中心、AI 伺服器、智慧終端裝置以及各類產業應用持續升級，半導體已成為全球科技發展與數位經濟的重要基礎設施，市場規模亦持續創下新高。根據 Semiconductor Industry Association (SIA) 預測，在 AI 基礎建設投資與高效能運算需求持續擴大的帶動下，2026 年整體市場規模有機會突破 1 兆美元。AI 運算、雲端資料中心與高速網路架構的快速發展，正成為推動半導體產業長期成長的核心動能。

受惠於人工智慧應用的蓬勃發展，高階算力晶片與超高速傳輸介面已躍升為技術演進核心。除前端設計與晶圓製造外，晶圓測試更是確保先進製程穩定產出的關鍵環節；其中，探針卡 (Probe Card) 作為晶圓測試不可或缺的核心介面，在確保高階晶片良率與優化測試效率方面，扮演著決定性的關鍵角色。

隨著先進封裝技術成為高效能晶片整合的主流方案，測試流程益發複雜，市場對高性能探針卡的需求亦隨之顯著提升。旺矽身為全球探針卡領導廠商，憑藉與全球頂尖 IC 設計大廠的長期合作，在建立堅實技術基礎的同時，更能精準掌握前瞻市場需求。據此，旺矽持續投注研發，不斷深耕關鍵技術，致力於高性能探針卡的創新研發，以卓越的產品規格滿足日益嚴苛的測試挑戰。

在半導體工程用及溫度測試等自製設上，預期也將跟著在人工智慧 (AI) 需求快速成長的帶動下，伴隨產品及服務優勢而逐步成長。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	114 年度	113 年度	增(減)%
財務收支	營業收入淨額		13,371,181	10,171,861	31.45%
	營業毛利		7,427,809	5,560,970	33.57%
	稅後損益		3,176,648	2,301,359	38.03%
獲利能力	資產報酬率(%)		15.97	16.08	-0.68%
	股東權益報酬率(%)		26.59	27.17	-2.13%
	營業利益占實收資本比率(%)		385.23	263.47	46.21%
	稅前純益占實收資本比率(%)		392.35	296.58	32.29%
	純益率(%)		23.75	22.61	5.04%
	每股盈餘(元)		33.49	24.42	37.14%

(三)研究發展狀況

本公司在一一四年度之研發成果包括：

1. 晶圓探針卡：

A. 因應 AI 高速運算的市場需求里程碑，本公司持續開發更高速測試探針卡，滿足客戶

- 在晶圓量產穩定測試之技術需求。
- B. 因應高階封裝的需求，推出微間距解決方案。
 - C. 因應 AI 高運算功能的需求，推出高針數解決方案。
 - D. 隨著汽車對輔助駕駛技術需求的不斷增加，車用 IC 需求與日俱增。為滿足客戶需要，開發大面積高同測，高低溫之探針卡，以因應車用 IC 客戶提升產能的產品需求。
 - E. 對應測試應用，建構探針卡混針解決方案。
2. 先進半導體測試設備：
- A. 推出矽光子晶粒等級量測設備，可運用於 PIC、EIC+PIC 晶圓切割後的 KGD 製成測試 (Known Good Die process)，包含相關的光電轉換特性量測，以及高頻元件的頻寬與雜訊測試。
 - B. 矽光子工程用晶圓測試設備，因應客戶不同電光輸出入位置，成功推出上下皆可架設光測試介面的雙向點測檢測機，以符合各客戶多樣的設計佈局。
 - C. 持續開發光通訊元件 VCSEL、EEL、DFB 等之光電特性量測設備。
3. 半導體元件溫度測試系統系列產品：
- 持續開發不同測試溫度範圍及流量之機種，以滿足客戶多工測試的需求，並搭配客戶系統的客製化整合機，提供量產及工程最適合的對應方案。

二、一一五年度營業計畫概要

(一)經營方針

技術是維持競爭力的核心基石，鑒於微電子產業之發展與未來技術需求，本公司秉持協助客戶提昇競爭力的核心理念，進行以下策略規劃與努力，以期與客戶一同成長：

1. 對應 AI 應用的快速發展，本公司持續開發高耐電流之探針及高耐電流整卡架構。
2. 因應 AI 需求，開發更高速的晶圓探針卡，以滿足下一世代之更高速傳輸的需求。
3. 為滿足高階 IC 製程微縮、高階封裝，本公司持續開發微間距之新技術。
4. 對應客戶高溫及高同測數的需求，本公司持續研發高溫大面積的探針卡技術。
5. 因應人工智能的高功能運算，持續開發高針數探針卡方案。
6. 半導體量產檢測解決方面，應用領域涵蓋矽光子 (Silicon Photonics)、射頻 (Radio Frequency)、化合物半導體 (LED、GaN、SiC 等) 等關鍵技術平台，提供高度整合光、機、電與軟體系統之自動化晶圓與晶粒量產測試設備。系統設計以高穩定度、高重複精度與高產能為核心，滿足先進製程於大規模生產環境下之嚴格測試需求。
7. 半導體工程檢測應用領域，強化各項產品功能與操作便利性，提昇更高頻更精準的量測能力，及更自動化的工程量測，使客戶能獲得更精準之量測結果與更高效率之工程實驗流程，加速驗證與產品開發時程。

(二)重要產銷政策

因應 AI 浪潮帶來產業各層面的新興應用市場，讓生活更智慧化、無接觸化、汽車電動化，本公司密切關注新興科技發展趨勢，訂定技術藍圖，將研發技術快速精確地導入新產品以擴展業務，並持續強化海外據點的支援能力，以期更快速精確的提供客戶完整的技術服務，進而提升產品市占率。

旺矽科技秉持協助客戶提昇競爭力的核心理念，將自身定位為客戶之技術合作夥伴，針對客戶未來的需求共同開發最適切的產品與即時的技術服務為主要產銷政策，為客戶提供最佳的解決方案。

三、未來公司發展策略

- (一) 在半導體工程檢測應用領域，以微小訊號、高頻量測、高功率、高低溫量測的技術領域，整合點測、分選、光電測試、影像檢測、自動化等核心技術，對應矽光子的發展，持續以創新的組合，提供矽光子不同階段發展的量測方案，強化產品競爭力。
- (二) 對應 AI 快速成長需求，投注研發 AI 溫控相關的產品，以溫控核心技術，持續開發半導體工程領域。並將溫度測試系統推展到 AI、車用、高頻通訊、傳感器、數據中心光纖等非電子量產市場。
- (三) AI 浪潮帶動電子產品轉型，促使晶片需求朝向高集成、低功耗、微型化發展。除了追求更卓越的智能化運算外，具備高度環境適應性與能源效率的晶片方案，已成為市場競爭的關鍵

指標。公司依照訂定的技術開發里程碑(roadmap)，持續開發大面積、高針數、微間距、高耐電流、高速傳輸、低針壓探針卡、耐高低溫測試的探針卡，滿足市場需求，確保競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

當前，半導體產業已從單純的科技分工，演進為全球科技競爭與地緣政治發展的交會點。受到外部環境劇烈變動影響，歐、美、日等主要經濟體為確保國家安全與科技自主，紛紛將半導體列為戰略發展重點。透過策略性投資與技術聯盟，各國持續深化跨國產業合作，旨在強化供應鏈韌性，進而形成合作與競爭並存的全球新格局。

旺矽為全球第三大非記憶體探針卡供應商，並持續推動全球化布局與在地化服務，積極提升國際市場競爭力。公司近年也陸續於美國及其他重要市場設立銷售與服務據點，進一步貼近客戶需求，帶動各產品線全球市佔率及品牌能見度的提升。

公司憑藉完整的半導體測試介面產品組合與長期且持續投注的全球營運網絡，能夠提供快速、高穩定性、高品質且高度客製化的解決方案，滿足先進製程、人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)等應用對測試技術日益提升的需求。

展望未來，隨著AI與高效能運算需求持續擴大，以及全球半導體供應鏈加速重塑，旺矽將持續深化全球布局、強化技術研發與客戶合作關係，致力於降低營運風險、提升長期獲利能力，並為股東創造穩健且持續的投資價值。

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事：

董 事 資 料(一)

115年4月30日 單位：股；%

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	旺矽投資(股)公司	-	112.06.15	3年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.51%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人--葛長林	男 61~70歲	112.06.15	3年	105.07.11	1,425,994	1.78%	1,425,994	1.46%	427,781	0.44%	0	0.00%	學歷：交通大學管理學院EMBA 經歷：工研院電子所	本公司：董事長 他公司：長洛國際(股)公司董事長、旺矽投資(股)公司董事長、MMI HOLDING CORP. 董事長、MPI TRADING CORP. 董事長、MPA TRADING CORP. 董事長、吉比鮮釀(股)公司董事長	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	旺矽投資(股)公司	-	112.06.15	3年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.51%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人--陳四桂	男 61~70歲	112.06.15	3年	101.08.01	230,283	0.29%	230,283	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：台灣大學機械研究所 經歷：工研院材料所	本公司：顧問 他公司：長洛國際(股)公司董事、旺矽投資(股)公司董事、均揚電子(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	旺矽投資(股)公司	-	112.06.15	3年	90.04.16	8,334,626	10.42%	8,334,626	8.51%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
		代表人--郭遠明	男 61~70歲	112.06.15	3年	101.11.26	438,037	0.55%	390,037	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南佛羅里達大學電機研究所 經歷：工研院機械所	本公司：總經理 他公司：長洛國際(股)公司董事、旺矽投資(股)公司監察人、均揚電子(股)公司董事長、旺矽科技(合肥)有限公司董事長	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	李篤誠	男 61~70歲	112.06.15	3年	90.04.16	599,349	0.75%	409,349	0.42%	414	0.00%	0	0.00%	學歷：逢甲大學企管系 經歷：長洛國際(股)公司	本公司：無 他公司：博磊科技(股)公司董事長、晨和投資有限公司董事長、贊鴻實業(股)公司董事長、博磊精密設備(蘇州)有限公司董事、Zen Voce(Pg)Sdn. Bhd 董事長、Zen Voce Manufacturing Pte Ltd. 董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	劉方勝	男 61~70歲	112.06.15	3年	90.04.16	255,471	0.32%	247,471	0.25%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：高雄醫學院牙醫系 經歷：台北市仁愛醫院	本公司：無 他公司：立誠牙科診所醫師	無	無	無	無
董事	中華民國	蔡長壽	男 61~70歲	112.06.15	3年	92.06.20	21,630	0.03%	21,630	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：文化大學會計系 經歷：台灣省政府主計處	本公司：無 他公司：勤信聯合會計師事務所執業會計師、廣隆光電科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	許梅芳	女 51~60歲	112.06.15	3年	90.04.16	244,441	0.31%	130,441	0.13%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：銘傳大學會計系 經歷：正風聯合會計師事務所	本公司：無 他公司：大亞聯合會計師事務所執業會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	高進振	男 61~70歲	112.06.15	3年	90.04.16	162,414	0.20%	160,414	0.16%	17,944	0.02%	0	0.00%	學歷：中興大學法律研究所 經歷：慧林法律事務所	本公司：無 他公司：高進振律師事務所主持律師、數泓科技(股)公司獨立董事、薪酬會委員及審計委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	廖大穎	男 61~70歲	112.06.15	3年	109.06.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：日本神戶大學法學博士 經歷：中興大學法律系教授	本公司：無 他公司：東海大學法律學院教授、通用幹細胞(股)公司獨立董事、薪酬會委員及審計委員會委員	無	無	無	無

(二)董事屬法人股東代表者，該法人股東之主要股東：

115年4月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
旺矽投資股份有限公司	葛長林	44.83%
	李篤誠	27.17%
	陳四桂	9.06%
	蔡淑錦	6.34%
	謝偉允	3.60%
	郭遠明	2.68%
	葛永綸	2.44%
	葛郁沛	2.36%
	葛郁笙	1.52%

(三)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

(1)董事專業資格與經驗

姓名		專業資格與經驗
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	畢業於交通大學管理學院 EMBA 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司之董事長，擁有產業相關專業之領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向企業永續經營。
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--陳四桂	畢業於台灣大學機械研究所 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司之顧問，專精於半導體相關領域之研究及創新，對公司產品研發及產品應用開發提供專業之經驗。
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--郭遠明	畢業於南佛羅里達大學電機研究所 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任本公司總經理，專精於公司營運管理，對生產管理及規劃、市場策略與業務拓展提供專業之經驗。
董事	劉方勝	畢業於高雄醫學院牙醫系 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任立誠牙科診所醫師，具有經營管理專業及公司治理專才經驗，能為公司營運發展提供重要建言，給與董事會適時監督及專業意見。
董事	李篤誠	畢業於逢甲大學企管系 具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗。 現任博磊科技股份有限公司董事長，具有產業及企業管理等專業領域之工作經驗及公司治理專才經驗，藉由其專長使其給與董事會適時監督並提供專業意見。
董事	蔡長壽	畢業於文化大學會計系 具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上會計師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任勤信聯合會計師執業會計師，具備財務會計專業資格能力及熟悉相關法令規定，能對公司提出具體建議，可發揮其專長及給予董事會監督並提供意見。
獨立 董事	許梅芳	畢業於銘傳大學會計系 具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上會計師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任大亞聯合會計師事務所執業會計師，具備專業背景並熟稔財會相關法規，能適時以專業客觀立場，提供本公司必要的監督與建議。

獨立董事	高進振	畢業於中興大學法律研究所 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上律師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任高進振律師事務所主持律師，具有法律專業並精通相關法令，於董事會及公司治理方面提供法律見解，公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。
獨立董事	廖大穎	畢業於日本神戶大學法學博士 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上法務或公司業務所需相關科系之公立大專院校教授之專業資格。 現任東海大學法律學院教授，法學方面具有深厚的學養，學術界地位崇高，熟稔公司治理，能提供董事會重要的法律知識及公司治理見解，對本公司助益良多。

(2)董事獨立性資訊

姓名		獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	不適用	無
董事	旺矽投資(股)公司 代表人—陳四桂		無
董事	旺矽投資(股)公司 代表人—郭遠明		無
董事	劉方勝	於選任前兩年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件： (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
董事	李篤誠	(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
董事	蔡長壽	(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
獨立董事	許梅芳	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或 配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	無
獨立董事	高進振	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計 金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相 關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。	1
獨立董事	廖大穎	(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會成員多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別及年齡等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事，每位董事皆具備包括法律、財務會計、產業知識、領導決策及經營管理等專業背景。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以三分之一女性董事席次為目標，未來將朝增加女性董事席次，以達成目標。

- 具員工身份之董事佔比為22%、獨立董事佔比為33%。
- 女性董事佔比為11%、男性董事佔比為89%。
- 1位獨立董事任期年資在3年至9年、2位獨立董事任期年資9年以上。
- 8位董事年齡在61至70歲、1位董事年齡在51至60歲。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

多元化 核心項目 董事會 成員	國籍	性別	兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			年齡		經營 管理 及 營業 判斷	財 務 及 會 計	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 與 決 策
				3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	51 到 60	61 到 70						
葛長林	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓
陳四桂	中華民國	男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
郭遠明	中華民國	男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
劉方勝	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓
蔡長壽	中華民國	男						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李篤誠	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓	✓

許梅芳	中華民國	女				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
高進振	中華民國	男				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
廖大穎	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少包含一名女性董事	已達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(二)董事會獨立性：

(1)本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事成員，獨立董事佔比為33%。

(2)本公司所有董事會成員間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第6-9頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事資料(請參閱本年報第4-5頁-董事資料)。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年4月30日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	郭遠明	男	99.06.15	390,037	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南佛羅里達大學電機研究所 經歷：工研院機械所	長洛國際(股)公司董事 旺矽投資(股)公司監察人 均揚電子(股)公司董事長 旺芯科技(合肥)有限公司董事長	無	無	無	無
設備營運中心副總經理	中華民國	范維如	男	97.07.01	75,034	0.08%	244	0.00%	0	0.00%	學歷：交通大學控制工程研究所 經歷：工研院機械所	無	無	無	無	
市場行銷副總經理	中華民國	劉永欽	男	100.06.20	9,211	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：成大航太工程系博士 經歷：工研院機械所	均揚電子(股)公司董事	無	無	無	無
財務主管 公司治理主管	中華民國	湯復評	男	108.05.07	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：中正大學財務金融所博士 經歷：正達國際光電股份有限公司	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	饒雲珍	女	96.03.09	47,251	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：明新科技大學企業管理系 經歷：崇越石英製造廠(股)公司	長洛國際(股)公司監察人 均揚電子(股)公司監察人 旺芯科技(合肥)有限公司監察人 旺矽科技(蘇州)有限公司監察人	無	無	無	無
南區製造處副處長	中華民國	汪建明	男	105.11.14	4,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：南亞工專機械科 經歷：尹嘉工業	無	無	無	無	
資安主管	中華民國	范文城	男	112.03.10	1,041	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：雪菲爾大學資訊管理研究所 經歷：台灣應用材料股份有限公司	無	無	無	無	

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)				
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 李篤誠、劉方勝、蔡長壽	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:葛長林 李篤誠、劉方勝、蔡長壽
	獨立董事:許梅芳、高進振、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進振、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進振、廖大穎	獨立董事:許梅芳、高進振、廖大穎
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)				
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)			一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明	一般董事: 旺矽投資(股)公司代表人:陳四桂 旺矽投資(股)公司代表人:郭遠明
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)				
100,000,000 元以上				
總 計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二)總經理及副總經理之酬金：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司(註1)	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
總經理	郭遠明														
副總經理	范維如	8,199	8,199	322	322	19,396	19,396	1,290	0	1,290	0	29,207 0.92%	29,207 0.92%	無	
副總經理	劉永欽														

註：退職退休金係為本公司提列提撥數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司(E)
低於1,000,000元		
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)		
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	范維如、劉永欽	范維如、劉永欽
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)		
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	郭遠明	郭遠明
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	3人	3人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	郭遠明	0	2,185	2,185	0.07%
	副總經理	范維如				
	副總經理	劉永欽				
	財務主管	湯復評				
	公司治理主管					
	會計主管	饒雲珍				
	分公司經理	汪建明				
資安主管	范文城					

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113年度		114年度		113年度		114年度	
	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例
董事酬金	93,841	4.08%	141,779	4.47%	93,841	4.08%	141,779	4.47%
總經理及副總經理酬金	17,517	0.76%	29,207	0.92%	17,517	0.76%	29,207	0.92%
稅後純益	2,301,359	-	3,176,648	-	2,301,359	-	3,176,648	-

說明：114年度董事之酬金總額較113年度增加，係因114年稅前獲利增加，致提撥董事酬金也增加。

1. 本公司對於董事酬金之發放，依公司章程中訂定提撥，本公司年度如有稅前獲利，應提撥不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞，並經薪資報酬委員會及董事會審議通過後，提請股東會核准。
2. 本公司總經理及副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理發放，並隨著經營績效之表現作適當調整，經薪資報酬委員會審議通過後，再提請董事會通過後完執行，本公司酬金政策係與盈餘相關，與未來風險無相關性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

114 年度董事會開會 10 次(A)董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%) (B/A)	備註
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人—葛長林	9	1	90%	
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--陳四桂	10	0	100%	
董事	旺矽投資(股)公司 代表人--郭遠明	9	1	90%	
董事	李 篤 誠	7	2	70%	
董事	劉 方 勝	9	1	90%	
董事	蔡 長 壽	10	0	100%	
獨立董事	高進根	10	0	100%	
獨立董事	許梅芳	10	0	100%	
獨立董事	廖大穎	9	1	90%	

114 年度各次董事會獨立董事出席狀況

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次	第 8 次	第 9 次	第 10 次
高進根	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
許梅芳	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
廖大穎	◎	◎	☆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參酌第 47 頁至第 48 頁董事會重要決議。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：請參酌第 47 頁至第 48 頁董事會重要決議。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：不適用。

三、本公司董事會、董事成員、審計委員會、薪酬委員會自我評鑑之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	董事會	董事會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	董事成員	董事成員 內部自評	1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。

				5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	審計委員會	審計委員會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知。 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	薪酬委員會	薪酬委員會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪酬委員會職責認知。 3. 提升薪酬委員會決策品質。 4. 薪酬委員會組成及成員選任。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一) 本公司依照「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於公司網站揭露董事會重要決議事項。
- (二) 本公司於 100 年 12 月 30 日成立薪資報酬委員會，日後係以專業客觀評估本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議，作為決策之參考。
- (三) 本公司於 109 年 6 月 15 日起設立審計委員會，由 3 名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司風險之管控評估。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

1. 財務報表。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與背書或保證。
6. 募集或發行有價證券。
7. 衍生性金融商品及現金投資情形。
8. 法規遵循。
9. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
10. 申訴報告。
11. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。
12. 資訊安全。
13. 公司風險管理。
14. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
15. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
16. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
17. 審計委員會職責履行情形。
18. 審計委員會績效評量自評問卷。

審閱財務報告

董事會造具本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託日正聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構(Internal Control-Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

114 年度審計委員會開會 10 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事 (召集人)	許梅芳	10	0	100%	
獨立董事	高進楨	10	0	100%	
獨立董事	廖大穎	9	1	90%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

董事會 日期	審計委員會 日期	議案內容及 後續處理	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
第 10 屆 第 11 次 114/01/14	第 2 屆 第 11 次 114/01/14	無討論事項	不適用	不適用
第 10 屆 第 12 次 114/03/12	第 2 屆 第 12 次 114/03/12	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 修訂本公司「公司章程」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		4. 113 年度內部控制制度聲明書之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		5. 本公司財務報表查核簽證會計師之變更案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		6. 評估 114 年度簽證會計師獨立性及適任性案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		7. 本公司擬繼續處分韓國子公司案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		8. 本公司自地委建二期工程追加案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 13 次 114/03/17	第 2 屆 第 13 次 114/03/17	1. 本公司擬購置湖口工業區之土地及廠房案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 14 次 114/04/22	第 2 屆 第 14 次 114/04/22	1. 擬買回本公司股份維護股東權益案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 15 次	第 2 屆 第 15 次	1. 本公司 114 年第一季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過

114/05/09	114/05/09			
第 10 屆 第 16 次 114/06/27	第 2 屆 第 16 次 114/06/27	1. 本公司擬 100% 收購 ATV 股權案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 17 次 114/08/13	第 2 屆 第 17 次 114/08/13	1. 修訂本公司「永續報告書編製及查證作業辦法」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 本公司 114 年第二季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		4. 本公司擬修訂國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		5. 註銷本公司庫藏股暨訂定減資基準日。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		6. 本公司擬進行湖口二廠自地委建工程案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		7. 本公司資金貸與韓國子公司 Megtas 之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 18 次 114/10/08	第 2 屆 第 18 次 114/10/8	1. 訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債 114 年第 3 季申請轉換普通股之發行新股基準日案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 本公司擬取得 ATV 股權案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 修訂本公司「薪工循環」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 19 次 114/11/10	第 2 屆 第 19 次 114/11/10	1. 本公司 114 年第三季財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 本公司 115 年度內部稽核計劃之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 本公司擬購置竹北土地及廠房案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第 10 屆 第 20 次 114/11/17	第 2 屆 第 20 次 114/11/17	1. 本公司擬取得 100% Focus 股權案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)本公司定期召開審計委員會並視需要邀請簽證會計師、財務主管、會計主管、內部稽核主管及相關主管列席。

(二)內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

(三)審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」，並已於本公司網站與公開資訊觀測站揭露相關內容。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已制定股東會議事規則，並依規定建立發言人與代理發言人制度，設置專人處理投資人關係與股東相關問題，公司網站亦設有投資人專區之處理窗口聯絡電話與 E-mail。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司委由股務代理機構，並定期更新股東名冊，以掌控公司股權最終控制者之名單。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		對關係企業間建立「子公司監理辦法」、「特定公司集團企業及關係人交易管理辦法」等控管制度。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「防範內線交易管理」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，本公司 114 年召開 10 次董事會，並通知董事、經理人開會日期以及各季財務報告之提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日 and 每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事及內部人誤觸該規定。	無差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		董事會成員落實多元化政策、具體管理目標及落實執行請參閱本年報第 8 至第 9 頁。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司尚未設置其他各類功能性委員會。	無差異

評估項目	運作情形			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		<p>本公司 109 年 1 月 14 日董事會決議通過訂定「董事會自我評鑑辦法」其評估的方式為成員自評，114 年度董事會績效考核、董事會成員績效考核、審計委員會績效考核、薪酬委員會績效考核等自評評估已於 115 年 3 月 11 日向董事會報告。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估範圍</th> <th>董事會績效考核</th> <th>董事會成員績效考核</th> <th>審計委員會績效考核</th> <th>薪酬委員會績效考核</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自評指標</td> <td>23 項</td> <td>16 項</td> <td>16 項</td> <td>12 項</td> </tr> <tr> <td>評分結果</td> <td>4.98 分</td> <td>4.98 分</td> <td>4.98 分</td> <td>4.89 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：自評指標及等級：1 非常不滿意；2 不滿意；3 普通；4 滿意；5 非常滿意。</p>	評估範圍	董事會績效考核	董事會成員績效考核	審計委員會績效考核	薪酬委員會績效考核	自評指標	23 項	16 項	16 項	12 項	評分結果	4.98 分	4.98 分	4.98 分	4.89 分	無差異					
評估範圍	董事會績效考核	董事會成員績效考核	審計委員會績效考核	薪酬委員會績效考核																				
自評指標	23 項	16 項	16 項	12 項																				
評分結果	4.98 分	4.98 分	4.98 分	4.89 分																				
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 115 年 3 月 11 日審計委員會決議通過後，並提報 115 年 3 月 11 日董事會決議通過。</p> <p>本公司會計師獨立性評估標準如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	評估項目	評估結果	委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。	是	委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。	是	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	是	委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。	是	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是	委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。	是	委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。	是	委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	是	委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	無差異
評估項目	評估結果																							
委任會計師與本公司並無有投資或分享財務利益之關係。	是																							
委任會計師本人並無與本公司有資金借貸之情事。	是																							
會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	是																							
委任會計師最近二年內並無擔任本公司有重大影響之職務。	是																							
對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是																							
委任會計師或審計服務小組成員並無握有本公司所發行之股票或其他證券。	是																							
委任會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人有重大影響職務之人員有親屬關係。	是																							
委任會計師並無擔任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	是																							
委任會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是																							

評估項目	運作情形			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		<p>本公司之公司治理主管負責公司治理相關事務，業經 112 年 3 月 10 日董事會通過設置，前項公司治理相關事務，至少應包括以下內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2) 製作董事會及股東會議事錄。 (3) 協助董事就任及持續進修。 (4) 提供董事執行業務所需之資料。 (5) 協助董事遵循法令。 (6) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (7) 辦理董事異動相關事宜。 (8) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 <p>114 年度本公司公司治理業務執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 114 年度完成召開 10 次董事會、10 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會。 (2) 114 年度召開 1 次股東常會。 (3) 114 年度安排董事進修 6 小時課程。 (4) 辦理董事會暨功能性委員會自行評估，並將績效評估結果於 115 年 3 月 11 日董事會報告。 	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		本公司已於公司網站建立與利害關係人溝通專區。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司已委任專業股務代辦機構華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		本公司股票代號為 6223，可透過公開資訊觀測站瞭解本公司財務業務及公司治理資訊之情形，本公司另設立網址： http://www.mpi.com.tw	無差異

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓		本公司設立之自有網址亦有英文說明，並指定發言人或代理發言人負責公司資訊之蒐集及揭露，以落實發言人制度。	無差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		本公司年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限內公告申報。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		(1)本公司依循法令規章制定工作規則，將人權及員工權益之保障明文規範在內，而對於往來之廠商、客戶皆保持互助合作之良好關係。 (2)本公司已設立公司治理實務守則，並執行相關運作情形。 (3)本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。 (4)本公司依『上市上櫃公司治理實務守則』規範，已為董事購買責任保險，相關資訊請於公開資訊觀測站查詢。 (5)為強化公司治理，本公司董事會會議每季至少召開一次。 (6)董事進修之情形已揭露於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)	無差異
九、請就台灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善提出優先加強事項與措施:本公司在各方面將不斷展現永續經營實力，亦將持續秉持誠信經營的企業社會責任，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。				

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年4月30日

條件 身份別 (註1)	姓名	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數

獨立董事 (召集人)	高進根	請參閱本年報第 4-5 頁,董事資料 (一)相關內容	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	1
獨立董事	許梅芳	請參閱本年報第 4-5 頁,董事資料 (一)相關內容	(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。	無
其他	蘇顯騰	畢業於成功大學法學博士 具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。 具有五年以上律師之國家考試及格領有證書之專門職業。 現任慧林法律事務所主持律師,具有法律專業並精通相關法令,於董事會及公司治理方面提供法律見解,公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。	(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	無

2. 薪資報酬委員會之職責

以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 15 日至 115 年 6 月 14 日，114 年度共開會 3 次(A)。

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	高進根	3	0	100%	
獨立董事 委員	許梅芳	3	0	100%	

其他 委員	蘇顯騰	3	0	100%	
董事會 日期	薪資報酬 委員會日期	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理	
第 10 屆 第 11 次 114/01/14	第 6 屆 第 6 次 114/01/14	核准 114 年度經理人之薪 資報酬項目案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
第 10 屆 第 12 次 114/03/12	第 6 屆 第 7 次 114/03/12	核准 113 年度董事及員工 之酬勞分配案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
第 10 屆 第 17 次 114/08/13	第 6 屆 第 8 次 114/08/13	發放 113 年度經理人之員 工酬勞討論案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席 董事同意通過	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(3)薪資報酬委員會職權範圍：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：

- ① 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- ② 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- ③ 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

4. 公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊

(1)本公司依循法令規章制定工作規則，將人權及員工權益之保障明文規範在內，而對於往來之廠商、客戶皆保持互助合作之良好關係。

(2)本公司已設立公司治理實務守則，並執行相關運作情形。

(3)本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之義務行使職權。

(4)本公司依『上市上櫃公司治理實務守則』規範，已為董事購買責任保險，相關資訊請於公開資訊觀測站查詢。

(5)為強化公司治理，本公司董事會會議每季至少召開一次。

(6)董事進修之情形已揭露於公開資訊觀測站(<http://newmops.tse.com.tw>)

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>1. 永續治理架構與高階參與 旺矽科技積極響應「上市櫃公司永續發展行動方案」，訂定《企業永續發展政策》，並設立 ESG 小組作為專職單位，於 111 年設立 ESG 永續委員會，由董事兼總經理擔任主席，協同各事業群高階主管，從核心營運能力出發，落實中長期永續發展藍圖，確保 ESG 策略與公司發展價值高度連結。</p> <p>2. 跨部門溝通與重大議題管理 ESG 永續委員會作為集團跨部門整合平台，設置功能性小組。透過每季定期會議，系統性辨識利害關係人關注議題，並擬定具體對應方針與 KPI，確保永續行動深植於日常營運流程。</p> <p>3. 董事會監督與年度執行成效 114 年度 ESG 永續委員會維持每季召開會議之慣例，重點涵蓋「法遵趨勢因應」、「風險管理追蹤」及「重大主題審核」。相關執行成果定期向董事會報告，並授權 ESG 永續委員會主席處理，於 114 年 8 月 13 日及 115 年 3 月 11 日已分別就「114 年度永續發展推動情形」與「利害關係人溝通情形報告」向董事會進行報告，並獲董事會核准授權執行。</p>	無差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 揭露範圍與邊界 本揭露資料涵蓋 114 年度（1 月 1 日至 12 月 31 日）之永續發展績效。風險評估邊界以旺矽科技股份有限公司坐落廠區為主。 2. 重大性分析流程與風險辨識 本公司參照 GRI 準則之重大性分析原則，蒐集內外部利害關係人溝通結果，包含首次針對內部中高階主管進行問卷調查，並透過 ISO 國際標準之利害關係人分析、產業情勢分析、及公司營運狀況評估進行綜合評估。114 年度特別強化供應鏈韌性與氣候變遷分析，藉此辨識具實質影響之 ESG 議題，並建立風險矩陣。 3. 風險管理政策與治理整合 針對辨識出之重大議題，本公司已訂定完善之辨識、衡量、監督及管控流程，並將 ESG 風險納入公司整體風險管理制度（由董事會與稽核室督導）。透過具體行動方案（如擴大範疇三碳盤查範圍等），有效降低潛在轉型風險，並轉化為長期營運之競爭優勢。 	無差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續精進法令遵循內控制度，遵循環保工安法令規定，辦理環境管理相關事務。 2. 通過環境管理系統(ISO 14001)驗證，有效期限為 2025 年 09 月 20 日至 2028 年 09 月 19 日。透過系統運作，檢視各流程對環境之影響，進而檢討及持續改善。 	無差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 依循國內環保標準，以及貿易當地國有關環保標準，包含 RoHS、無鹵素規範等。並持續辦理各種資材回收再利用、製程原物料與包材採用低污染材料、再生物料，以降低環境負荷之衝擊。 2. 積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化，同時於 114 年針對竹北廠導入 EMS 能源管理系統，預計 115 年開始運作進行有限能源監控與推動減量作業，並透過 ISO 50001 能源管理系統導入並定期評估，提升能源使用效率，近一年(114)節能總度數已達到 69.44 萬度電。 	無差異

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																														
	是	否		摘要說明																													
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		有關氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於本年報附表二之二之三。 無差異																														
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>1. 溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報附表二之二之三。</p> <p>2. 用水量(涵蓋範圍；母公司全廠區)，通過 ISO 14001 環境管理系統驗證</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113 年(m³)</th> <th>114 年(m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新竹各廠</td> <td>172,910.32</td> <td>193,063.49</td> </tr> <tr> <td>高雄廠區</td> <td>15,078.23</td> <td>17,320.60</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>187,988.55</td> <td>210,384.09</td> </tr> <tr> <td>密集度(註)</td> <td>18.48</td> <td>18.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：密集度= m³/當年母公司百萬元營收</p> <p>3. 廢棄物量(涵蓋範圍；母公司全廠區)，通過 ISO 14001 環境管理系統驗證</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113 年(Ton)</th> <th>114 年(Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事業廢棄物</td> <td>278.48</td> <td>323.61</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>23.54</td> <td>89.27</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>302.02</td> <td>412.88</td> </tr> <tr> <td>密集度(註)</td> <td>0.03</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：密集度= Ton /當年母公司百萬元營收</p> <p>4. 依循 ISO 14001、50001 環境與能源管理系統，持續針對事業廢棄物、用水與能源進行有效控制與減量規劃，詳請見 https://www.mpi.com.tw/esg/#environment</p> 無差異		113 年(m ³)	114 年(m ³)	新竹各廠	172,910.32	193,063.49	高雄廠區	15,078.23	17,320.60	總計	187,988.55	210,384.09	密集度(註)	18.48	18.10		113 年(Ton)	114 年(Ton)	一般事業廢棄物	278.48	323.61	有害事業廢棄物	23.54	89.27	總計	302.02	412.88	密集度(註)	0.03	0.02
	113 年(m ³)	114 年(m ³)																															
新竹各廠	172,910.32	193,063.49																															
高雄廠區	15,078.23	17,320.60																															
總計	187,988.55	210,384.09																															
密集度(註)	18.48	18.10																															
	113 年(Ton)	114 年(Ton)																															
一般事業廢棄物	278.48	323.61																															
有害事業廢棄物	23.54	89.27																															
總計	302.02	412.88																															
密集度(註)	0.03	0.02																															
四、社會議題																																	

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		<p>1. 政策制定與國際接軌 本公司恪遵國內《勞動基準法》等相關勞動法規，並參照《聯合國工商企業與人權指導原則》、ICESCR、CEDAW 等國際人權相關公約，以及《責任商業聯盟行為準則 (RBA)》等行業規範，制定《人權政策》及相關管理程序，將保障人權之精神落實於工作規則及各項營運準則中。</p> <p>2. 核心價值與禁止歧視 本公司依據《人力資源管理程序》等相關規定，明確保障員工之勞動人權，包含但不限於：禁止僱用童工、反對強制勞動、嚴禁職場歧視與騷擾、落實多元包容與薪酬平等，並確保員工擁有合法的結社自由與集體協商權利。</p> <p>3. 盡職調查與救濟機制 本公司定期辦理 RBA「人權盡職調查」，辨識包括員工、供應商及當地社區之潛在人權風險。針對可能受影響之對象，設有暢通且具匿名性之檢舉與申訴管道（含專用信箱與內部溝通平台），並訂定完善之調查程序與身分保護機制，確保人權保障非僅止於規章，而能落實於日常監督。</p>	無差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司員工福利措施與實施情形，詳請參閱本年報（第 75~78 頁）	無差異

推動項目	執行情形				與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																																	
	是	否	摘要說明																																																																			
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>1. 本公司已通過 ISO45001 職業安全衛生驗證，有效期限為 2025 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日。</p> <p>2. 本公司定期辦理作業環境測定、員工健康檢查、健康講座、安全衛生教育訓練、醫師駐點健康諮詢等活動；設置集乳室、醫務室、員工休息室、準媽媽車位等關懷設施，以提供一個安全舒適及員工樂於工作之環境。</p> <p>公司近二年人員職業安全衛生教育訓練：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">訓練項目</th> <th colspan="2">2024 年</th> <th colspan="2">2025 年</th> </tr> <tr> <th>次數</th> <th>人數</th> <th>次數</th> <th>人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進人員職業安全衛生教育訓練</td> <td>64</td> <td>314</td> <td>59</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td>在職人員職業安全衛生教育訓練</td> <td>2</td> <td>1,674</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職業安全衛生管理人員教育訓練</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>有害作業主管教育訓練</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>31</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：在職人員職業安全衛生教育訓練每兩年一次</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th colspan="2">員工失能傷害</th> <th>承攬商失能傷害</th> <th>重大職災</th> <th>職災比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>2 件</td> <td>2 人</td> <td>0 件</td> <td>0 件</td> <td>0.11%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0 件</td> <td>0 人</td> <td>0 件</td> <td>0 件</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：職災比率=員工人數/員工總人數</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>火災演練</th> <th>毒災演練</th> <th>火災件數</th> <th>死傷人數</th> <th>死傷比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>2 次</td> <td>0 次</td> <td>0 件</td> <td>0 人</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2 次</td> <td>2 次</td> <td>0 件</td> <td>0 人</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：毒災演練每兩年一次</p>		訓練項目	2024 年		2025 年		次數	人數	次數	人數	新進人員職業安全衛生教育訓練	64	314	59	359	在職人員職業安全衛生教育訓練	2	1,674	0	0	職業安全衛生管理人員教育訓練	7	7	16	16	有害作業主管教育訓練	17	17	31	31	年度	員工失能傷害		承攬商失能傷害	重大職災	職災比率	2024	2 件	2 人	0 件	0 件	0.11%	2025	0 件	0 人	0 件	0 件	0%	年度	火災演練	毒災演練	火災件數	死傷人數	死傷比率	2024	2 次	0 次	0 件	0 人	0%	2025	2 次	2 次	0 件	0 人	0%	無差異
訓練項目	2024 年		2025 年																																																																			
	次數	人數	次數	人數																																																																		
新進人員職業安全衛生教育訓練	64	314	59	359																																																																		
在職人員職業安全衛生教育訓練	2	1,674	0	0																																																																		
職業安全衛生管理人員教育訓練	7	7	16	16																																																																		
有害作業主管教育訓練	17	17	31	31																																																																		
年度	員工失能傷害		承攬商失能傷害	重大職災	職災比率																																																																	
2024	2 件	2 人	0 件	0 件	0.11%																																																																	
2025	0 件	0 人	0 件	0 件	0%																																																																	
年度	火災演練	毒災演練	火災件數	死傷人數	死傷比率																																																																	
2024	2 次	0 次	0 件	0 人	0%																																																																	
2025	2 次	2 次	0 件	0 人	0%																																																																	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>本公司已定期舉辦員工職涯能力發展教育訓練課程，詳請參閱本年報第 76 頁。</p>		無差異																																																																	

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<p>1. 政策制定與國際準則遵循 本公司為 B2B 交易模式，無消費性產品，且無須蒐集個人資料有關資訊。惟本公司仍高度重視客戶隱私權益與產品安全，依據 ISO 9001 品質管理以及 ISO 27001 資訊安全有關規定，制定《品質手冊》、《資訊安全政策手冊》、《個人資料保護管理辦法》等，嚴格遵循《消費者保護法》、歐盟一般資料保護規範 (GDPR)、資通安全法及相關行業國際準則。</p> <p>2. 客戶隱私與資訊安全管理 為維護客戶隱私，本公司建立嚴謹的資訊安全防護機制與個資處理流程，確保客戶資料僅用於授權之商業用途。定期針對新進員工與在職員工辦理資訊隱私保護教育訓練（參訓率 100%），且年度內未發生任何侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴案件。</p> <p>3. 完善申訴程序與溝通機制 本公司設有專職之客戶服務權責單位，提供透明且暢通之申訴與建議管道（含官方網站專區及專用客服信箱）。針對客戶反饋，訂定客戶申訴機制與售後服務標準化之處理時效與結案追蹤程序，確保客戶意見能迅速獲得回應與改善，並將客戶滿意度調查結果納入年度管理審查評核。</p>	無差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 供應鏈管理流程 本公司已制定《供應商管理程序》與《供應商管理作業指導書》，明確要求合作夥伴(含供應商及承攬商)必須在環境保護(如禁限用物質、減碳行動)、職業安全衛生(如工傷預防)及勞動人權(如禁止童工、薪酬平等)等議題遵循國際準則(如 RBA 責任商業聯盟行為準則)及在地法規。 2. 評估與約束 本公司推動供應商簽署「供應商責任商業聯盟行為準則承諾書」、並進行永續風險調查作業，將 ESG 表現納入合格供應商評選項目。於承諾書明定：承諾所供應之產品及服務內容皆遵守 RBA 規定並得配合本公司進行實地稽核作業。 3. 風險評估與實施情形 每年定期針對各類別採購額前十大供應商進行永續風險調查，並依調查結果進行稽核作業。114 年度共針對 22 家關鍵與特定供應商進行書面審查與現場訪視，評估結果為中或低風險。針對未達標者，本公司提供具體改善建議並追蹤複查，確保供應鏈韌性與永續轉型目標同步。 	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司依據全球永續性報告協會(GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2025 年永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群(包含其人權)重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，並參考永續會計準則理事會(SASB)準則揭露行業指標資訊及 SASB 指標對應報告書內容索引。 2. 2025 年永續報告書包含對應 GRI 準則之內容索引。2025 年永續報告書無取得第三驗證單位確信或保證意見。 	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司重視永續經營發展，已分別於 111 年成立 ESG 永續發展專案、ISO 14064-1 溫室氣體盤查暨查證專案，推動公司永續作業。本公司積極參與永續金融方案，112 年 3 月承作「綠色及永續新臺幣定期存款」達 1 億元，綠色投資為投入再生能源、綠建築融資，社會效益投資則包括均衡城鄉發展、弱勢照顧、興建教育設施及醫療院所等項目，展現對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。113 年 11 月承作「綠色定期存款」新台幣達 1 億元，綠色存款專案之金額，將運用於各項符合綠色債券原則項目或聯徵中心認可「綠色授信」註記之規範，綠色投資為投入再生能源案場融資、綠建築融資、電動車融資、廢轉能發電站融資、廢污水處理廠及其相關基礎建設融資等項目，持續投入永續發展。

114 年度捐贈慈善公益團體情形：

項次	受捐單位	捐款金額
1	國立臺灣大學醫學院附設醫院(支持醫療人才永續發展專案)	5,000,000
2	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 (四家公司合捐一台心臟超音波)	2,082,500
3	新竹縣政府警察局竹北分局(捐贈一台巡邏車)	942,079
4	社團法人世界和平會	324,000
5	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	180,000
6	社團法人台灣工業技術研究院院友會	150,000
7	新竹縣立交響管樂團	75,000
8	梅門功藝坊	50,000
9	社團法人中華民國救世慈善協會	29,109
10	社團法人中華安得烈慈善協會	20,967
11	社團法人中華基督教救助協會	19,921
12	新北市流浪動物保護協會	18,000
13	財團法人屏東縣私立磐石社會福利事業基金會	17,881
14	社團法人炬輪技藝發展協會	16,567
15	財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會	16,176
16	財團法人喜憨兒社會福利基金會	14,376
17	社團法人新竹縣竹北市泰和社區發展協會	10,000
合計		8,966,576

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>1. 董事會之監督職能 本公司董事會為氣候相關議題之最高決策與監督機關，負責審核氣候變遷因應策略、減碳目標及相關投資規劃。董事會每季聽取氣候風險與溫室氣體執行進度作業之專案報告，監督氣候風險管理執行情形，並確保溫室氣體盤查與查證進度（依據 ISO 14064-1）符合國家永續發展路徑圖與法令規範，於 114 年共報告四次並予以同意執行。</p> <p>2. 管理階層之決策與執行 由總經理召集之 ESG 永續委員會，每年一次透過 ISO 22301 管理審查會議辨識實體風險（如洪水、乾旱、極端高溫）及轉型風險（如法規變遷、市場趨勢），並將氣候風險納入公司整體風險管理制度，針對關鍵資產及營運據點制定韌性應對方案，確保在氣候衝擊下仍能維持穩定的產品與服務供應。</p> <p>3. 跨部門組織分工與工具運用 透過 ISO 14001、50001 管理審查會議作業，並於 ESG 永續委員會報告，負責追蹤國內外環境法規與國際準則。本公司運用「氣候變遷災害風險調適平台」進行科學化評估，針對臺灣據點之脆弱度進行定量分析。管理階層透過導入之 EMS 能源管理系統與碳盤查管理系統，落實減碳績效，並每季向委員會及董事會匯報指標達成情形，形成完善的「辨識、評估、管理、監督」治理體系。</p>												
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>有關氣候變遷議題之風險與機會共有 32 項，經整理後可歸納以下：</p> <table border="1" data-bbox="799 1641 1366 2089"> <thead> <tr> <th>類型</th> <th>風險／機會</th> <th>因應策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>轉型風險</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 綠色轉型與技術開發不易，產品需求變化 影響公司聲譽與接單能力 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地之綠色規範 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃 </td> </tr> <tr> <td>實體風險</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 水災(自身營運、供應鏈) 旱災(自身營運、供應鏈) 高溫(自身營運、供應鏈) 提高天災緊急應對能力 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力 </td> </tr> <tr> <td>氣候相</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 提升廠房能源使用效率與節能措施 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 新廠區節能措施建置規劃(太陽能設置、廢水回收設 </td> </tr> </tbody> </table>	類型	風險／機會	因應策略	轉型風險	<ul style="list-style-type: none"> 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 綠色轉型與技術開發不易，產品需求變化 影響公司聲譽與接單能力 	<ul style="list-style-type: none"> 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地之綠色規範 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃 	實體風險	<ul style="list-style-type: none"> 水災(自身營運、供應鏈) 旱災(自身營運、供應鏈) 高溫(自身營運、供應鏈) 提高天災緊急應對能力 	<ul style="list-style-type: none"> 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力 	氣候相	<ul style="list-style-type: none"> 提升廠房能源使用效率與節能措施 	<ul style="list-style-type: none"> 新廠區節能措施建置規劃(太陽能設置、廢水回收設
類型	風險／機會	因應策略											
轉型風險	<ul style="list-style-type: none"> 國內外溫室氣體與綠色規範法令遵循嚴峻 綠色轉型與技術開發不易，產品需求變化 影響公司聲譽與接單能力 	<ul style="list-style-type: none"> 國內外碳稅與碳費徵收尚未對旺矽科技造成財務影響，仍持續密切關注國內外溫室氣體法規要求，以及銷售當地之綠色規範 提前因應規劃減碳策略與碳權交易作業準備 與工研院等公協會專家合作，針對耗能廠務設備進行節能輔導 關注市場變化與透過研調機構進行產業分析 因應客戶稽核／調查需求提前布局 ESG 執行規劃 											
實體風險	<ul style="list-style-type: none"> 水災(自身營運、供應鏈) 旱災(自身營運、供應鏈) 高溫(自身營運、供應鏈) 提高天災緊急應對能力 	<ul style="list-style-type: none"> 導入 ISO 22301 營運持續管理系統，針對衝擊大之風險建立應變計畫以提高風險發生之應變能力 											
氣候相	<ul style="list-style-type: none"> 提升廠房能源使用效率與節能措施 	<ul style="list-style-type: none"> 新廠區節能措施建置規劃(太陽能設置、廢水回收設 											

	<p>關機會</p> <ul style="list-style-type: none"> · 再生能源與儲能設備建置 · 研發高效能、環境友善產品 · 提升企業商譽 · 提高營運持續韌性 <ul style="list-style-type: none"> · 海內外子公司溫室氣體盤查逐步導入與新建廠太陽能設置，提高子公司氣候因應能力 · 與大專院校合作研究，持續針對產品技術方法革新與替代材料研究 · 驗證 ISO 22301 營運持續管理系統，提高客戶信任與增強營運韌性 · 導入 EMS 能源管理系統，針對耗能高之設施設備進行偵測與監控
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>1. 實體風險之財務衝擊評估</p> <p>本公司參考 ISO 14091 氣候變遷調適指引，並結合 ISO 22301 營運持續管理系統（BCM），辨識出強降雨（洪災）、乾旱及極端高溫為主要實體風險。其潛在財務影響如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 營收中斷風險：強降雨引發之洪災可能導致營運據點部分停工或物流受阻，進而產生延遲交貨之違約金或當期營收減損。 · 資產損失風險：極端高溫可能導致廠務與生產設備過熱損毀，增加非計畫性維修支出與設備折舊減損。 · 營運成本增加：乾旱期間為維持產線運作，需支付額外之水車運送費用及水資源回收系統之電費，將導致營業成本上升。 <p>2. 轉型行動之財務規劃</p> <p>為因應低碳轉型法規與市場需求（如客戶、CDP 等組織要求），本公司採取積極財務對策：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 資本支出規劃：針對高能耗廠務設施與製程設備，投入 EMS 智慧能源管理系統，透過精準控溫降低電力損耗及設備燒毀風險。 · 內部碳定價應用：計畫導入內部碳定價（ICP）作為投資評估工具，將未來的碳成本支出納入財務模型，優化高效率低能耗設備之回收期計算，確保資本配置能有效抵禦政策轉型帶來的財務壓力。 · 風險抵禦與財務韌性：透過足額的財產保險移轉殘餘風險。同時，藉由新建廠廢水回收設施與再生能源設施，強化公司在氣候衝擊下的財務穩定性與現金流韌性。
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>1. 高層監督與風險治理架構</p> <p>本公司將氣候變遷視為轉型風險。董事會為風險控管之最高決策單位，負責核定風險管理政策並監督執行成效。由總經理領導之 ESG 永續委員會，每季定期向董事會報告，確保氣候相關實體風險</p>

	<p>與轉型風險之辨識與因應。</p> <p>2. 導入國際標準強化營運韌性 為落實氣候變遷因應策略，本公司於 113 年（2024 年）正式導入 ISO 22301 營運持續管理系統（BCM），建立標準化管理手冊與應變程序。透過從上而下的治理模式，將氣候極端事件可能引發的產線中斷、供應鏈受阻及財務波動，轉化為可控的營運風險。本公司已於 113 年取得第三方驗證機構（LRQA）之證書，證書有效期為 114 年 1 月 6 日至 117 年 1 月 5 日，確信本公司之營運持續管理體系符合國際標準且具備實質運作能力。</p>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>1. 情境設定與科學參數 本公司參酌 TCFD 框架針對氣候風險執行情境分析。在實體風險方面，採用 IPCC RCP 8.5（高排放情境）評估極端降雨與高溫對營運據點之衝擊；在轉型風險方面，則參考我國碳費徵收路徑，設定碳價參數與能源轉型成本。分析因子包含降雨量變化率、平均氣溫升幅。</p> <p>2. 韌性分析與營運持續整合 本公司依據 ISO 31000 風險管理架構，並結合已取得第三方驗證之 ISO 22301（BCM）體系，將情境分析結果導入營運持續計劃（BCP）。針對評估後可能受氣候事件嚴重衝擊之「關鍵營運活動（PAs）」，建立韌性分級制度。透過情境模擬，確保公司在不同全球升溫路徑下，均能維持核心產線的運作能力。</p> <p>3. 主要財務影響與資源配置 根據情境分析結果，本公司針對「主要財務影響」採取預先支應措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 財務支援與準備：針對高風險資產，優先撥付資本支出，設置防水閘門、冷熱與溫溼度控制設施，以及 EMS 能源管理系統，以應對氣候風險。 • 風險轉嫁與現金儲備：透過足額的產物保險移轉財務衝擊，並根據情境預估之潛在損害額度，確保充足的現金水位與財務彈性。
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>1. 淨零轉型計畫路徑與內容 本公司依據「臺灣 2050 淨零路徑」，於 113 年（2024 年）11 月經董事會核定通過盤查與減量計畫，並於 114 年 1 月正式啟動。該計畫涵蓋範疇一與範疇二之減量，核心策略包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 低碳營運與設備優化：全面導入 ISO 50001 能源管理系統（EMS），並透過「廠務設施能效提升專案」進行老舊空調及空

	<p>壓機汰換。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 再生能源極大化：既有廠區已建置 963kW 太陽能發電系統，並規劃於新廠區同步導入再生能源自發自用設施；同時設置電動車充電樁，推動低碳通勤。 · 淨零技術與抵換布局：評估參與具備國際查證標準之碳抵換 (Carbon Offset) 專案，針對現階段技術難以消滅之殘餘排放量進行抵銷準備。 <p>2. 實體風險與轉型風險之辨識指標</p> <p>本公司建立雙軌指標體系，據以辨識並監控氣候風險之變動：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 實體風險指標：以「各產線因極端天氣致停工天數」及「關鍵供應商因天災致供貨中斷可承受天數」為監控指標，用以辨識強降雨 (洪災) 與乾旱對營運持續性之威脅。 · 轉型風險指標：以「溫室氣體排放強度 (每億元營收排放量)」及「碳費徵收條件與費用」為關鍵指標，監控法規碳費徵收與供應鏈低碳要求之影響。 <p>3. 轉型目標與達成進度</p> <p>本公司設定短中長期目標如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 短期目標 (2025-2029 年)：完成集團合併報表範圍之 ISO 14064-1 盤查與第三方確信，較基準年減碳 5%。 · 中期目標 (2030 年)：溫室氣體排放量較基準年 (2022 年) 減量 10~20% (範疇一+二)。 · 長期目標 (2040 年)：實現碳中和。
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>本公司將依 IFRS 實施時程評估規劃內部碳定價作業。</p>
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>1. 減碳目標與規劃期程</p> <p>本公司以 111 年首次盤查溫室氣體做為排放基準年，制定「2040 減碳目標路徑圖」，涵蓋範圍包括母公司及合併報表之所有子公司。目標設定如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 短期目標 (2025-2029 年)：完成集團合併報表範圍之 ISO 14064-1 盤查與第三方確信，較基準年減碳 5%。 · 中期目標 (2030 年)：較基準年減量 10~20% (範疇一、二)。 · 長期目標 (2040 年)：實現碳中和。 <p>2. 排放範疇與涵蓋活動</p> <p>溫室氣體所盤查涵蓋之活動包含營運活動有關之產品研發、製造生產及運輸等。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 範疇一 (Scope 1)：公務車燃料、製程排放等。 · 範疇二 (Scope 2)：外購電力之能源間接排放等。

	<ul style="list-style-type: none"> • 範疇三 (Scope 3)：如購買之商品與服務、資本財等。 <p>3. 每年達成進度與資源運用 母公司已完成 112 年度溫室氣體盤查。包含母公司、子公司長洛國際 (CLIC)、旺矽蘇州 (MPS) 之 114 年度之盤查與查證作業正依規劃進行中，預計於 115 年第二季完成。</p> <p>4. 憑證與抵換情形 目前本公司優先投入內部節能減碳工程與再生能源自產自用，114 年度尚未使用再生能源憑證 (RECs) 或碳抵換 (Carbon Offsets) 機制。未來將視減碳路徑需求，滾動式評估購買具國際公信力機構之減碳額度。</p>
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳以下說明。

1、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1) 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。					
溫室氣體排放涵蓋範圍；母公司全廠區					
盤查年	範疇一	範疇二	範疇三	總計	密集度 (CO ₂ e/當年母公司百萬元營收)
2024 年	1,432.9036	19,171.9760	7,405.4156	28,010.2952	3.21
2025 年	3,181.2737	20,883.6613	9,120.9450	33,185.8800	2.85

(2) 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已於 2026 年 5 月完成查證 (查證單位：LRQA)。 2. 查證範圍：範疇一、範疇二、範疇三 (類別 4：組織使用產品產生之間接溫室氣體排放) 3. 上述查證依據 ISO 14064-1:2018、ISO 14064-3:2019 以及 Greenhouse Gas Protocol，查證範圍包含本公司臺灣所有據點廠區，長洛國際 (CLIC)、旺矽蘇州 (MPS) 均無保留意見。

2、溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
--

1. 本公司於 2024 年設定減碳目標(範疇 1 與 2)，2025 年 1 月執行，目標如下(以 2022 年為減碳基準年)：
 - (1) 第一階段 2027 年減碳 5%；
 - (2) 第二階段 2030 年減碳 10~20%；
 - (3) 第三階段 2040 年實現碳中和。
2. 針對第一階段，已於 2025 年 1 月啟動減碳專案，預計投資 2,500 萬元進行如下：
 - (1) 設備汰換與升級-遵循 ISO5001 能源管理系統標準，提出節能方案。
 - (2) 全面能源健檢-與公協會合作展開各廠區能源健檢，提出節能方案與 EMS 建制方案。
 - (3) EMS 可視化管理-建置智慧化 EMS 能源系統，分析優化能源使用及配置，並透過能源監控提出有效益的節能方案。
 - (4) 自願減量專案-將符合申請資格的節能方案向環境部申請自願減量專案，取得碳權額度，作為未來抵換碳費使用及碳中和目標宣告。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. 政策制定與董事會核定 本公司秉持「誠信原則」之核心經營理念，由董事會通過訂定《誠信經營守則》建立嚴謹之誠信治理架構。本公司承諾在所有商業活動中，嚴禁收受賄賂、禁止不正交易及尊重智慧財產權，確保公司營運完全遵循《公司法》、《證券交易法》、《營業秘密法》、《智慧財產法》及相關法規。 2. 專責單位與落實機制 為落實誠信經營，董事會授權人力資源部擔任推動單位，並制定《誠信經營與從業道德規範》，每年一次向董事會報告誠信經營執行情形，包含教育訓練成效、檢舉案件處理及風險評估結果。 3. 經營階層承諾與對外明示 本公司董事會與高階管理階層鄭重承諾，將積極督導誠信政策之落實，並對不誠信行為採取「零容忍」態度。此承諾已明確揭露於公司年報、官方網站及永續報告書中。此外，本公司亦要求供應商簽署「誠信廉潔承諾書」，要求合作夥伴 	無差異

			共同遵循，以建構透明、公平的商業環境。	
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓	1. 建立風險評估機制 本公司已建立「不誠信行為風險評估機制」，由誠信經營推動單位每年針對整體營業範圍進行盤點。透過辨識具較高不誠信行為風險之營業活動，分析其發生機率與影響程度。每年進行一次「勞工及道德風險評估」，評估對象涵蓋全體員工及關鍵營運流程，確保風險控管。 2. 訂定防範方案 針對辨識出之高風險活動，本公司於《誠信經營與從業道德規範》中訂定具體防範方案。措施嚴格涵蓋《上市上櫃公司誠信經營守則》第七條第二項各款行為，包括： · 防範收受賄賂與不正當利益：明訂利益衝突申報制度，114年針對潛在高風險單位人員進行利益衝突申報與審核。 · 防範非法政治獻金與不當捐贈：訂定核決權限與審核流程，確保所有對外捐贈均符合公益性與法規。 · 防範侵犯智慧財產權與不公平競爭：強化商業機密保護與法遵稽核，防範洩密或違背受託義務之行為。 3. 落實獎懲與監督制度 本公司將誠信經營納入內部控制制度，由審計委員會及董事會定期監督。對於違反誠信行為者，明訂《員工獎懲辦法》並落實執行，以確保防範方案非僅止於規章，而能實質降低營私舞弊、挪用公款或謊報等不誠信風險，維護公司永續經營之誠信文化。		無差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	1. 完善制度與行為指南 本公司已於《誠信經營守則》及《誠信經營與從業道德規範》中，明定各項營業活動之誠信作業程序與行為規範。相關處		無差異

		<p>理流程均對外揭露於公司官網 https://www.mpi.com.tw/esg/ue-diligence-governance/ethical-business-practices/，作為全體從業人員及商業夥伴之行為遵循標準。</p> <p>2. 建立獨立申訴與舉報制度 本公司設有獨立之檢舉管道獨立檢舉信箱與免付費檢舉專線，並由人資部負責受理。檢舉制度具備以下機制以確保落實執行：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 匿名舉報與身分保密：明訂受理檢舉人應對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，且嚴禁對檢舉人採取任何報復或不當對待。 · 標準作業程序：建立報案、調查、審議及回饋之標準程序。 <p>3. 違規懲戒與定期檢討機制 本公司嚴格落實違規懲戒制度，若員工違反誠信規範，經查證屬實者，依工作規則予以懲處，情節嚴重者將終止勞動契約或依法訴追。誠信經營推動單位每年定期檢討防範方案之有效性，114 年度已完成檢討並於 114 年 11 月 10 日向董事會進行執行成效報告，確保誠信文化之持續演進與深化。</p>	
二、落實誠信經營			
<p>(一)公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓	<p>1. 建立往來對象誠信評估機制 本公司於與供應商、客戶或其他商業往來對象建立商務關係前，均依據《誠信經營守則》及相關採購管理程序，進行「保密合約」(NDA)、「誠信廉潔承諾書」簽署。如有涉及賄賂、違反公平競爭或曾有不誠信行為將進行紀錄與保全證據，確保公司之商業鏈符合誠信標準。</p> <p>2. 於契約中明定誠信與保密條款 本公司於主要商業契約中，除訂定嚴謹之「保密協議」外，亦納入「誠信經營條款」。條款內容明定往來對象應遵守本公司之誠信政策，嚴禁提供非法利益、回扣或進行不正當競</p>	無差異

		<p>爭。</p> <p>3. 違約終止與救濟機制 若交易對象涉及不誠信行為，且對本公司之信譽或營運造成顯著影響時，依據相關承諾書或契約規定本公司得隨時逕行終止或解除契約，並依法追究相關法律責任。透過事前評估與事後契約約束，有效落實公司之誠信經營政策，確保永續發展之商業環境。</p>	
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓	<p>1. 由本公司人力資源部兼職推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等。</p> <p>2. 誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告，最近一次報告日期為 2025 年 11 月 10 日，主要報告誠信經營之政策、作法、執行情形，最近一次報告項目如下，並獲董事會認可並同意持續作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 教育訓練辦理：參訓人數 306 人次，合計 306 人時。 • 新進人員服務合約書簽署：應簽署人數 306 人，已簽署 306 份，達成比率 100%。 • 利益衝突申報：(包含新進人員及潛在高風險部門人員)，應申報人數 610 人，已申報 610 人，占全體員工比率 30.29%。 • 申訴、舉報管道：(包含專用電話及專用信箱)，經查核收到檢舉案件 1 件。 • 勞工及道德風險評估：評估對象 1909 人，評估內容 62 項，皆落在微風險等級(可忽略或稍加注意)。 	無差異
<p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	✓	<p>1. 董事層級之利害關係迴避 本公司已於《董事會議事規範》及《誠信經營守則》中明確訂定利益衝突防止要求。董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害</p>	無差異

		<p>於公司利益之虞時，應於當次董事會主動說明其利害關係之重要內容，且不得加入討論及表決，並應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>2. 員工行為準則與主動申報機制</p> <p>本公司透過《誠信經營與從業道德規範》、《員工獎懲辦法》及《服務合約書》，建構全方位之利益衝突防範體系。要求員工應嚴格遵守利益迴避準則，對於涉及潛在利益衝突之道德疑慮事項，設有通報機制。此外，透過簽署具法律約束力之「競業禁止條款」，有效防止員工利用職務之便謀取不正當利益，維護公司經營績效與商業機密。</p> <p>3. 提供陳述管道與落實監督</p> <p>本公司設有暢通之檢舉信箱與免付費檢舉專線，確保員工及利害關係人於發現潛在衝突時能即時回饋。誠信經營推動單位每年定期辦理「利益衝突申報」，114 年度針對關鍵職務及管理階層已完成申報作業。</p>	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓	本公司建立有效之會計制度、內部控制制度，稽核人員並定期查核制度遵循之情形。	無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	本公司 114 年度舉辦誠信經營、從業道德、反貪腐等議題教育訓練，參訓人數 306 人次，合計 306 人次。	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	<p>1. 建立具體檢舉與獎勵制度</p> <p>本公司已於《誠信經營與從業道德規範》中，明定具體之檢舉制度與檢舉獎勵措施，鼓勵內外部利害關係人主動舉報不誠信或違法行為，藉此型塑廉潔之企業文化，落實誠信經營之監督。</p> <p>2. 提供多元且便利之檢舉管道為確保舉報之便利性與及時性，本公司建立多軌並行之獨</p>	無差異

		<p>立申訴管道，並對外揭露於官方網站 https://www.mpi.com.tw/esg/ue-diligence-governance/ethical-business-practices/ 及內部公告，所有管道均由專人控管，並嚴格執行檢舉人身分保密與反報復保護機制：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 外部管道：設有專屬獨立檢舉信箱 (whistleblower@mpi.com.tw) 及免付費檢舉專線 (0800-888-089)。 · 內部管道：於員工內網設置意見信箱及舉報專區，確保員工能隨時反映違法或不當行為。 <p>3. 指派適當之受理專責人員 本公司指派人力資源部擔任檢舉受理之專責單位。針對涉及董事或高階管理階層之檢舉案件，本公司訂有特殊處理程序，受理由審計委員會直接督導調查，確保調查過程之公正性與獨立性。</p>	
<p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	<p>✓</p>	<p>1. 標準化調查作業程序 本公司已建立《誠信經營與從業道德規範》，明定檢舉案件之標準作業程序(SOP)。檢舉案件受理後，由人力資源部專責進行初步審核與立案，並視案件性質啟動調查程序。所有調查過程均詳實記錄於「違反誠信、道德行為自主通報(或檢舉)調查處理記錄表」，確保調查內容之完整性、專業性與可追溯性。</p> <p>2. 嚴謹之身分保密與反報復機制 本公司承諾對檢舉人身分及檢舉內容採取最高等級之保密機制。調查過程中，僅限必要之核心調查人員參與，嚴禁洩漏任何足以辨識檢舉人身分之資訊。制度內明確規範檢舉人保護措施，確保檢舉人不因檢舉行為而遭受解僱、降職、減薪或任何不</p>	<p>無差異</p>

		<p>當之處置，並提供必要支援。</p> <p>3. 後續處理措施與高層監督調查完成後，本公司依事實認定採取後續措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 違規處置：若查證屬實，依《員工獎懲辦法》予以懲戒，情節嚴重者終止勞動契約並依法訴追。 · 制度改善：針對案件暴露之管理漏洞進行檢討，並修正相關防範方案。 · 特殊情形呈報：涉及董事或高階管理階層之案件，或影響金額達一定標準時，受理單位須立即向審計委員會及董事會報告，並由獨立董事全程監督調查過程，確保處置之公正、獨立且不被干預。 	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	本公司依據《誠信經營與從業道德規範》對檢舉人的個人資料與資訊安全政策予以嚴格保密(高機密性)，且可匿名檢舉等措施保護。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司網站及公開資訊觀測站已揭露「誠信經營守則」，同時將誠信經營成效與推動成果揭露於 ESG 永續報告書與官方網站 https://www.mpi.com.tw/esg/duediligence-governance/ethical-business-practices/ 。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

114 年本公司董事進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	旺矽投資股份有限公司代表人：葛長林	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
董事	旺矽投資股份有限公司代表人：陳四桂	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3

			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
董事	旺矽投資股份有限公司代表人:郭遠明	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
董事	李篤誠	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.11	企業併購、股東間協議與法務法令遵循	3
董事	劉方勝	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
董事	蔡長壽	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
獨立董事	高進根	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
獨立董事	許梅芳	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3
獨立董事	廖大穎	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
			114.11.10	企業如何防範貪腐	3

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

旺矽科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：115年3月11日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國115年3月11日董事會通過，出席董事九人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。



旺矽科技股份有限公司

董事長：葛長林

簽章



總經理：郭遠明

簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

董事會之重要決議：

董事會重要決議日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理
第 10 屆 第 11 次 114.1.14	本公司 114 年度營運計畫之討論案		
	114 年度員工暨董事酬勞提撥比率之討論案		無
	薪資報酬委員會審議本公司經理人之薪資報酬之討論案		無
第 10 屆 第 12 次 114.3.12	113 年度員工暨董事酬勞分派案		無
	113 年度營業報告書及財務報表案	✓	無
	113 年度盈餘分配現金股利之討論案		無
	修訂本公司「公司章程」之討論案	✓	無
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	✓	無
	113 年度內部控制制度聲明書之討論案	✓	無
	114 年股東常會日期、地點及議程之討論案		無
	本公司財務報表查核簽證會計師之變更案	✓	無
	評估 114 年度簽證會計師獨立性及適任性案		無
	本公司擬繼續處分韓國子公司股權案		無
本公司自地委建二期工程追加案	✓	無	
第 10 屆 第 13 次 114.3.17	本公司擬購置湖口工業區之土地及廠房案	✓	無
第 10 屆 第 14 次 114.4.22	買回本公司庫藏股案	✓	無
第 10 屆 第 15 次 114.5.9	本公司 114 年第一季財務報告	✓	無
	增列 114 年股東常會議案之報告事項議案		無
第 10 屆 第 16 次 114.6.27	本公司擬 100%收購 ATV 股權案		無
第 10 屆 第 17 次 114.8.13	修訂本公司「永續報告書編製及查證作業辦法」案	✓	無
	訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案	✓	無
	113 年永續報告書討論案		無
	薪資報酬委員會提送本公司經理人之員工酬勞案		無
	本公司 114 年第二季財務報告案	✓	無
	本公司擬修訂國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案	✓	無
	註銷本公司庫藏股，並訂定減資基準日	✓	無
本公司湖口二廠自地委建工程案	✓	無	

	本公司資金貸與韓國子公司之討論案	✓	無
第 10 屆 第 18 次 114.10.8	訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債 114 年第 3 季申請轉換普通股之發行新股基準日案	✓	無
	本公司擬取得 ATV 股權案		無
	修訂本公司「薪工循環」案	✓	無
第 10 屆 第 19 次 114.11.10	本公司 114 年第三季財務報告案	✓	無
	本公司 115 年度內部稽核計劃之討論案	✓	無
	本公司擬購置竹北土地及廠房案	✓	無
第 10 屆 第 20 次 114.11.17	本公司擬取得 100% Focus 股權案		無
第 10 屆 第 21 次 115.1.12	本公司 115 年度營運計畫之討論案		無
	115 年度員工暨董事酬勞提撥比率之討論案		無
	薪資報酬委員會審議本公司經理人之薪資報酬之討論案		無
	訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債 114 年第 4 季申請轉換普通股之發行新股基準日案	✓	無
	修訂本公司「薪工循環」案	✓	無
第 10 屆 第 22 次 115.3.11	114 年度員工暨董事酬勞分派案		無
	114 年度營業報告書及財務報表案	✓	無
	114 年度盈餘分配現金股利之討論案		無
	修訂本公司「公司章程」案	✓	無
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓	無
	修訂本公司「永續發展實務守則」案	✓	無
	評估本公司「基層員工」範圍定義案	✓	無
	114 年度內部控制制度聲明書之討論案	✓	無
	評估 115 年度簽證會計師獨立性及適任性案	✓	無
	改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案		無
	本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案		無
	本公司第十一屆董事(含獨立董事)候選人提名案		無
115 年股東常會日期、地點及議程之討論案		無	
第 10 屆 第 23 次 115.4.8	本公司擬購置湖口工業區之土地及廠房案	✓	無
	本公司擬募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債案	✓	無
第 10 屆 第 24 次 115.5.13	115 年第 1 季合併財務報告	✓	無

114 年度股東常會之重要決議執行情形：

股東常會重要決議日期	重要決議	執行情形
股東常會	承認 113 年度營業報告書及財務報表案	全體出席股東無異議照案通過

114.06.11	承認 113 年度盈餘分派案	全體出席股東無異議照案通過，現金股利配發 16 元。 除息基準日：114.07.18 現金股息發放日：114.08.08
	本公司「公司章程」修正案	執行情形：於 114 年 7 月 18 日獲經濟部函准，並公告於公司網站。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十一)其他應揭露事項：

114 年度本公司公司治理主管、會計主管及稽核主管進修情形如下：

職稱	姓名	進修機構	進修日期	課程名稱	進修時數
公司治理主管	湯復評	社團法人中華公司治理協會	114.10.08	企業併購時不可忽視的風險-併購之法律盡職調查	3
		金融監督管理委員會	114.10.16	第十五屆臺北公司治理論壇	6
		社團法人中華公司治理協會	114.11.10	企業如何防範貪腐	3
會計主管	饒雲珍	財團法人中華民國會計研究發展基金會	114.11.13 至 114.11.14	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	劉怡萍	內部稽核協會	114.05.19	從「營運循環看企業合約」實務研討	6
		內部稽核協會	114.10.15	智能稽核時代：AI 系統稽核與 AI 輔助稽核	6

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
日正聯合會計師事務所	巫貴珍	114.01.01 至 114.12.31	3,478	346	3,824	稅務簽證公費 316 仟元、CB5 發行新股公費 30 仟元
	陳燦煌	114.01.01 至 114.12.31				

(二)公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

- (1)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。
- (2)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- (3)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

- (一)關於前任會計師：不適用。
- (二)關於繼任會計師：不適用。
- (三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

- (一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	114 年度		當年度截至 115 年 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	旺矽投資(股)公司 代表人:葛長林	0	0	0	0
董事	旺矽投資(股)公司 代表人:陳四桂	0	0	0	0
董事	旺矽投資(股)公司 代表人:郭遠明	0	0	0	0
董事	劉方勝	(8,000)	0	0	0
董事	李篤誠	0	0	0	0
董事	蔡長壽	0	0	0	0
獨立董事	許梅芳	(3,000)	0	0	0
獨立董事	高進振	0	0	0	0
獨立董事	廖大穎	0	0	0	0
總經理	郭遠明	(2,000)	0	0	0
副總經理	范維如	0	0	0	0

副總經理	劉永欽	0	0	0	0
財務主管 公司治理主管	湯復評	0	0	0	0
會計主管	饒雲珍	0	0	0	0
分公司經理	汪建明	0	0	0	0
資安主管	范文城	0	0	1,041	0

(二)股權移轉資訊或股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115年4月30日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
旺矽投資股份有限公司 負責人:葛長林	8,334,626	8.51%	0	0%	0	0%	旺矽投資(股)公司	本公司董事	無
	1,425,994	1.46%	427,781	0.44%	0	0%	旺矽投資(股)公司	本公司董事長	無
新制勞工退休基金	8,318,755	8.49%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
德盛科技大壩基金專戶	3,594,000	3.67%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
舊制勞工退休基金	2,513,802	2.57%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
德盛台灣大壩基金專戶	1,992,000	2.03%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,939,000	1.98%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,647,900	1.68%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
永豐商銀受旺矽科技員工持股信託財產專戶	1,617,596	1.65%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	1,564,000	1.60%	0	0%	0	0%	無	無關係	無
彰化商業銀行股份有限公司受託保管統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金專戶	1,489,000	1.52%	0	0%	0	0%	無	無關係	無

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

114年12月31日 單位：股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之 投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
長洛國際(股)公司	5,000,000	100%	0	0	5,000,000	100%
MPI TRADING CORP.	1,000	100%	0	0	1,000	100%
MMI HOLDING CO., LTD.	15,667,987	100%	0	0	15,667,987	100%
均揚電子(股)公司	1,550,000	100%	0	0	1,550,000	100%
MEGTAS CO., LTD.	500,000	100%	0	0	500,000	100%
MPA TRADING COR.	11,450,000	100%	0	0	11,450,000	100%
ATV Systems GmbH	0	100%	0	0	0	100%
MPI AMERICA INC. (註2)	0	0%	6,300,000	子公司 100% 持有	6,300,000	100%
旺芯科技(合肥)有限公司 (註3)	0	0%	13,400,000 美元	子公司 100% 持有	13,400,000 美元	100%
旺矽科技(蘇州)有限公司 (註4)	0	0%	2,000,000 美元	子公司 100% 持有	2,000,000 美元	100%
Celadon Systems Inc. (註5)	0	0%	1,000	子公司 100% 持有	1,000	100%

註1：係公司之長期投資。

註2：係本公司之子公司 - MPA TRADING CORP. 之轉投資公司。

註3：係本公司之子公司 - MMI HOLDING CO., LTD. 之轉投資公司。

註4：係本公司之子公司 - MMI HOLDING CO., LTD. 之轉投資公司。

註5：係本公司之子公司 - MPI AMERICA INC. 之轉投資公司。

參、募集情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

115年4月30日 單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
84/07	10	500	5,000	500	5,000	設立資本	無	
87/10	10	22,500	225,000	6,000	60,000	現金增資 55,000 仟元	無	
89/07	15 10	22,500	225,000	10,000	100,000	現金增資 28,000 仟元 盈餘轉增資 12,000 仟元	無	
90/05	18 10 10	22,500	225,000	20,000	200,000	現金增資 50,700 仟元 盈餘轉增資 42,000 仟元 員工紅利轉增資 7,300 仟元	無	
91/06	10	50,000	500,000	30,000	300,000	盈餘轉增資 43,800 仟元 員工紅利轉增資 6,200 仟元	受讓長洛公司股份 50,000 仟元	註 1
92/09	10	50,000	500,000	33,434	334,340	盈餘轉增資 30,000 仟元 員工紅利轉增資 4,340 仟元	無	註 2
93/08	10	50,000	500,000	33,803	338,031	可轉債轉換普通股 3,691 仟元	無	
93/09	10	50,000	500,000	37,672	376,719	盈餘轉增資 33,434 仟元 員工紅利轉增資 5,254 仟元	無	註 3
93/11	10	50,000	500,000	38,217	382,174	可轉債轉換普通股 5,454 仟元	無	
94/02	10	50,000	500,000	38,877	388,775	可轉債轉換普通股 6,601 仟元	無	
94/05	10	50,000	500,000	39,556	395,556	可轉債轉換普通股 6,781 仟元	無	
94/07	10	50,000	500,000	39,576	395,765	可轉債轉換普通股 208 仟元	無	
94/09	10	51,300	513,000	48,957	489,568	盈餘轉增資 81,960 仟元 員工紅利轉增資 11,814 仟元 可轉債轉換普通股 30 仟元	無	註 4
94/10	10	51,300	513,000	49,253	492,533	可轉債轉換普通股 2,964 仟元	無	
95/02	10	51,300	513,000	50,479	504,785	可轉債轉換普通股 12,253 仟元	無	
95/05	10	51,300	513,000	50,724	507,236	可轉債轉換普通股 2,451 仟元	無	
95/08	10	51,300	513,000	50,815	508,145	可轉債轉換普通股 909 仟元	無	
95/09	10	58,000	580,000	56,496	564,959	盈餘轉增資 50,814 仟元 員工紅利轉增資 6,000 仟元	無	註 5
96/08	10	100,000	1,000,000	56,501	565,005	可轉債轉換普通股 45 仟元	無	
96/09	10	100,000	1,000,000	63,676	636,758	盈餘轉增資 57,500 仟元 員工紅利轉增資 8,118 仟元 可轉債轉換普通股 6,135 仟元	無	註 6
96/10	10	100,000	1,000,000	63,679	636,789	可轉債轉換普通股 30 仟元	無	
97/01	10	100,000	1,000,000	63,736	637,363	可轉債轉換普通股 574 仟元	無	
97/09	10	100,000	1,000,000	71,105	711,053	盈餘轉增資 64,570 仟元 員工紅利轉增資 9,120 仟元	無	註 7
98/08	10	100,000	1,000,000	73,311	733,111	盈餘轉增資 21,190 仟元 員工紅利轉增資 868 仟元	無	註 8
98/12	10	100,000	1,000,000	74,084	740,841	員工認股權轉換普通股 100 仟元 可轉債轉換普通股 7,630 仟元	無	
99/04	10	100,000	1,000,000	77,449	774,486	員工認股權轉換普通股 11,190 仟元 可轉債轉換普通股 22,455 仟元	無	
99/07	10	100,000	1,000,000	77,629	776,291	員工認股權轉換普通股 11,082 仟元 可轉債轉換普通股 3,200 仟元	無	
99/10	10	100,000	1,000,000	77,697	776,970	員工認股權轉換普通股 5,376 仟元 可轉債轉換普通股 200 仟元	無	

100/01	10	100,000	1,000,000	77,985	779,854	員工認股權轉換普通股13,149仟元 可轉債轉換普通股8,900仟元	無
100/04	10	100,000	1,000,000	78,464	784,644	員工認股權轉換普通股39,613仟元	無
100/08	10	100,000	1,000,000	78,549	785,494	員工認股權轉換普通股7,030仟元	無
100/10	10	100,000	1,000,000	78,590	785,904	員工認股權轉換普通股3,299仟元	無
101/01	10	100,000	1,000,000	78,602	786,024	員工認股權轉換普通股931仟元	無
101/04	10	100,000	1,000,000	78,605	786,054	員工認股權轉換普通股233仟元	無
101/07	10	100,000	1,000,000	78,610	786,104	員工認股權轉換普通股388仟元	無
102/07	10	100,000	1,000,000	78,612	786,123	員工認股權轉換普通股143仟元 股東申請拋棄持股之註銷減資8股	無
104/01	10	100,000	1,000,000	79,536	795,364	可轉債轉換普通股92,400仟元	無
104/05	10	100,000	1,000,000	79,605	796,054	可轉債轉換普通股6,900仟元	無
106/08	10	100,000	1,000,000	79,901	799,014	可轉債轉換普通股26,700仟元	無
108/08	10	120,000	1,200,000	79,915	799,154	可轉債轉換普通股1,000仟元	無
109/01	10	120,000	1,200,000	79,959	799,587	可轉債轉換普通股3,000仟元	無
109/08	10	120,000	1,200,000	80,294	802,940	可轉債轉換普通股23,200仟元	無
109/10	10	120,000	1,200,000	91,068	910,684	可轉債轉換普通股726,200仟元	無
110/01	10	120,000	1,200,000	92,080	920,802	可轉債轉換普通股68,200仟元	無
110/04	10	120,000	1,200,000	92,381	923,813	可轉債轉換普通股20,300仟元	無
110/08	10	120,000	1,200,000	93,000	930,001	可轉債轉換普通股41,700仟元	無
110/11	10	120,000	1,200,000	94,074	940,738	可轉債轉換普通股69,900仟元	無
111/04	10	120,000	1,200,000	94,078	940,784	可轉債轉換普通股300仟元	無
111/11	10	120,000	1,200,000	94,231	942,311	可轉債轉換普通股9,500仟元	無
114/09	10	120,000	1,200,000	94,151	941,511	庫藏股註銷減資80,000股	無
114/11	10	120,000	1,200,000	94,931	949,311	可轉債轉換普通股712,500仟元	無
115/01	10	120,000	1,200,000	97,981	979,813	可轉債轉換普通股2,786,200仟元	無

註1：經財政部證券暨期貨管理委員會91.06.03(91)第09100127510號函核准。

註2：經財政部證券暨期貨管理委員會92.07.02台財證一字第0920129426號函核准。

註3：經財政部證券暨期貨管理委員會93.06.15台財證一字第0930126472號函核准。

註4：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局94.6.16金管證一字第0940124109號函核准。

註5：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局95.7.17金管證一字第0950130971號函核准。

註6：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局96.7.12金管證一字第0960036186號函核准。

註7：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局97.6.25金管證一字第0970031732號函核准。

註8：經行政院金融監督管理委員會證券期貨局98.7.8金管證發字第0980034020號函核准。

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	97,981,309股	22,018,691股	120,000,000股	上櫃公司股票

(二)主要股東名單

115年4月30日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
旺矽投資股份有限公司	8,334,626	8.51%
新制勞工退休基金	8,318,755	8.49%
德盛科技大壩基金專戶	3,594,000	3.67%
舊制勞工退休基金	2,513,802	2.57%
德盛台灣大壩基金專戶	1,992,000	2.03%
公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,939,000	1.98%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1,647,900	1.68%
永豐商銀受旺矽科技員工持股信託財產專戶	1,617,596	1.65%
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	1,564,000	1.60%
彰化商業銀行股份有限公司受託保管統一台股增長主	1,489,000	1.52%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

第十九條：本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞，其中員工酬勞數額中，保留提撥不低於百分之五十做為基層員工分派酬勞之用；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

第二十條：本公司目前產業發展屬成長階段，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬定盈餘分派案，提報股東會。

盈餘之分派將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放，以不低於股利總額之 10% 為原則。

2. 本年度股東會擬議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分派案，業經 115 年 3 月 11 日之董事會通過擬議配發股東現金股利新台幣 2,155,588,798 元(每股新台幣 22 元)。

3. 股利政策預期是否有重大變動：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東常會未擬議無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

第十九條：本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞，其中員工酬勞數額中，保留提撥不低於百分之五十做為基層員工分派酬勞之用；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

第二十條：本公司目前產業發展屬成長階段，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬定盈餘分派案，提報股東會。

盈餘之分派將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放，以不低於股利總額之10%為原則。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分配金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之零點一至百分之十五作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞，其中員工酬勞數額中，保留提撥不低於百分之五十做為基層員工分派酬勞之用；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。如實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司114年度盈餘分配議案，已於民國115年3月11日董事會決議通過，有關董事會通過之擬議盈餘分配情形如下：

- (1) 以現金分派之員工酬勞新台幣341,842,000元及董事酬勞新台幣85,460,544元，與認列費用年度估列金額並無差異。
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分配情形(包括分配股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

單位：新台幣元

項 目	金 額
員工現金酬勞	249,429,000
董事酬勞	62,357,391

113年度員工及董事酬勞實際分派金額與認列金額無差異。

(六)買回本公司股份情形(已執行完畢者)：

買回期次	第四次(期)
買回目的	維護股東權益
買回期間	114.06.04~114.06.04
買回區間價格	781.56元
已買回股份種類及數量	普通股 80,000股
已買回股份金額	62,524,936元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	4.00%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 80,000股
累積持有本公司股份數量	80,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.08%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容如下：
 - (1) 電腦及週邊設備維護買賣研發。
 - (2) 半導體元件、電子零件、晶體積體電路之進出口買賣。
 - (3) 精密自動化控制機器之進出口買賣。
 - (4) 機械及其零件之進出口買賣。
 - (5) 一般進出口貿易業務。(許可業務除外)
 - (6) 半導體測試零組件加工維修、製造、進出口買賣。
 - (7) 代理國內外廠商前各項產品之報價、投標業務。
 - (8) 機械設備製造業。
 - (9) 機械批發業。
 - (10) 機械器具零售業。

2. 營業比重

本公司 114 年度合併營收淨額為新台幣 13,371,181 仟元，營收來源主要是晶圓探針卡及半導體設備之銷售，其各商品（服務）之營業比重如下：

單位：新台幣仟元

商品（服務）項目	114 年度	
	銷售淨額	營業比重%
晶圓探針卡	9,657,136	72.22%
半導體設備	3,490,967	26.11%
其他	223,078	1.67%
合計	13,371,181	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

- (1) 晶圓探針卡
- (2) 晶圓探針卡維修
- (3) 晶圓測試與分選設備
- (4) 半導體晶圓與元件之測試、分選與光學檢查設備

4. 計畫開發之新商品(服務)

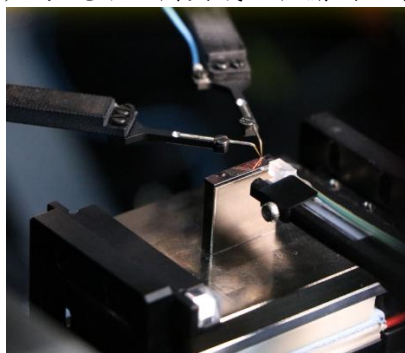
- (1) 晶圓探針卡
 - (a) 因應半導體晶圓製程技術規格的提升，持續開發極小間距、高針數、大面積、高低溫、少清針及多晶片平行測試之晶圓探針卡。
 - (b) 因應高速、高頻晶片發展的趨勢，持續開發高速、高頻測試之晶圓探針卡。
 - (c) 因應先進封裝技術發展及應用產品的不同，持續開發高整合度的 FOWLP、KGD、覆晶、CIS、TSV、WLP、SiP、SoC、2.5D、InFO、CoWoS、矽光子、Chiplet 及 3D 立體堆疊晶片測試用之先進式晶圓探針卡。
- (2) 半導體設備
 - (a) 半導體晶圓工程用測試設備，包含 RF、高功率元件等半導體相關晶圓點測設備。



(b) Micro LED 微顯示元件、光通訊元件之化合物半導體晶圓級測試系統。



(c) 矽光子晶圓與成品相關測試系統。



(二) 產業概況

(A) 產業之現況與發展

(1) 全球行業現況

(a) 晶圓探針卡(半導體產業)

半導體產業鏈上游為 IC 設計業，中游為 IC 晶圓製造，下游為 IC 封裝測試。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠製作成晶圓半成品，完成前段晶圓測試後，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，再將測試後之成品裝配成為產品。

IC 測試則可分為兩階段，一是進入封裝之前的晶圓測試，主要測試晶片上晶粒的電性。另一則為 IC 成品測試，主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常，以確保品質。探針卡則是使用於晶圓測試階段，對晶片上的每個晶粒進行針測。

探針卡(Probe Card)是一片佈滿探針的電路板，為測試機台和待測晶圓間測試分析的介面；晶圓製作完成後，需要透過探針卡測試晶圓品質，檢測出品質優良、或不良(瑕

疵或故障)的 IC (integrated circuit, 晶粒)；後續封裝流程中，只有品質優良的 IC 進入封裝程序，而品質不良的 IC 則避免封裝造成不必要的成本浪費。

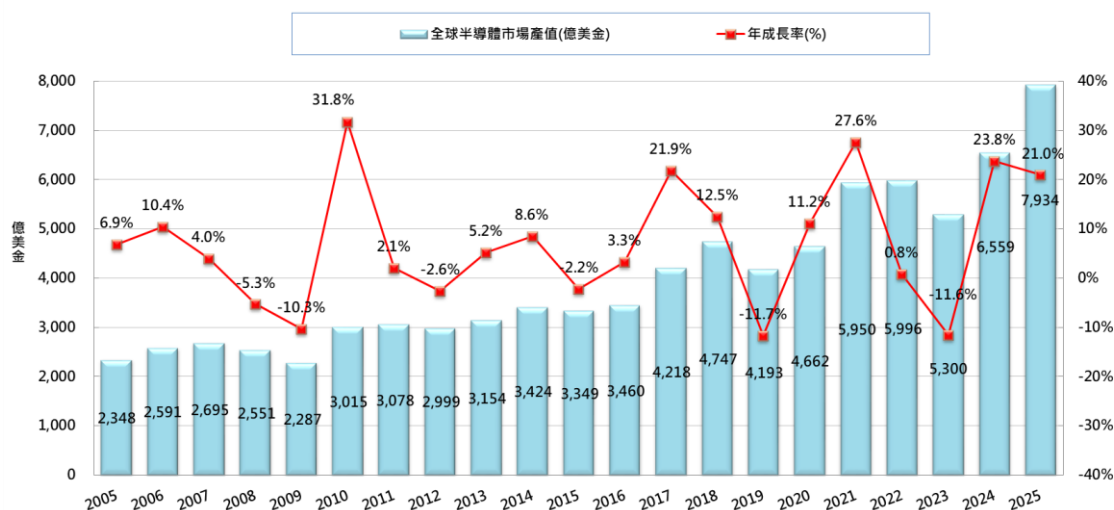
每一種類型的 IC 至少需一片相對應之探針卡。探針卡的工作原理係藉由設置於探針卡上的探針(probe needles)與待測晶片(Devices Under Test, DUT)上的鉑墊(pad)或凸塊(bump)接觸進行針測(Probe test)，輸入及輸出晶片訊號以進行電性量測，再配合周邊測試儀器與軟體控制達到自動化量測。

晶圓經針測之後，晶圓依晶粒為單位切割成獨立的晶粒，再讓合格的晶粒繼續進到後段 IC 封裝製程，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，可保護晶粒以免受汙染，並有助後續裝配流程，達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。由於 IC 封裝的成本在整體 IC 生產上所佔比例較高，故避免不良晶粒進入後段封裝製程，可顯著地控制構裝成本、避免不必要的浪費。

伴隨電子產品朝向薄型化、高效能及低功耗方向，未來高階封裝的成本勢必提高，是以減少構裝浪費的晶圓針測技術已經成為 IC 產業中重要的一環。

台灣 IC 封裝與測試產業穩坐全球之冠，隨著 AI、HPC 應用興起，台灣 IC 封裝與測試業者正加速布局高階封裝與異質整合技術，以鞏固領先優勢並拉開與競爭業者之差距；在此同時，探針卡供應商及測試設備廠也全力投入新技術開發，緊跟產業趨勢，以持續維持領先地位。

全球半導體市場預測



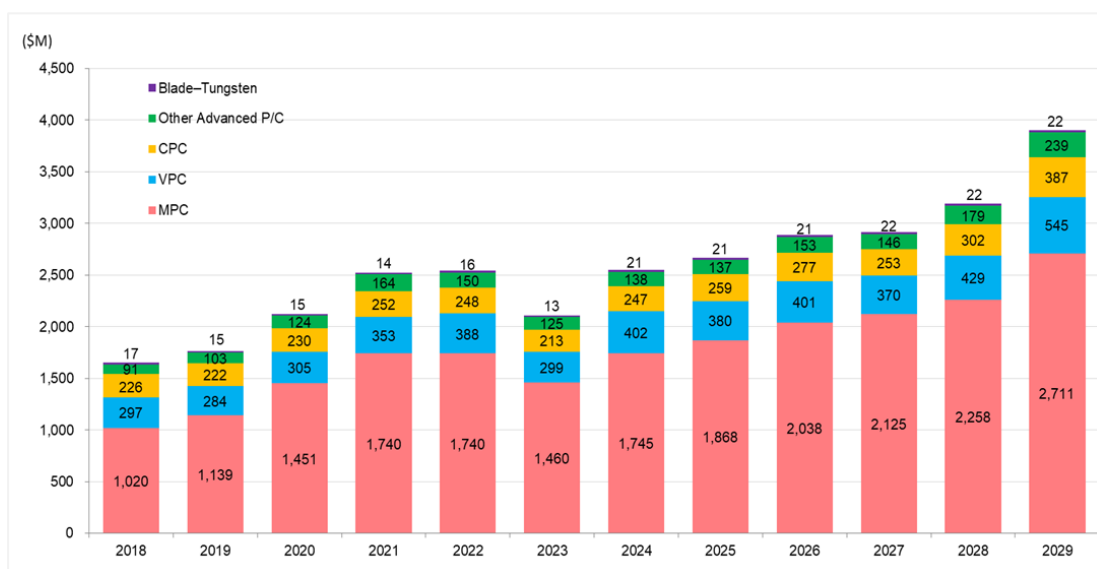
資料來源：Gartner (2026/01)；旺矽彙整

晶圓探針卡與半導體產業發展息息相關，其市場動能深受產業景氣波動影響。根據市調機構 Gartner 調查報告資料，2025 年全球半導體營收達到 7,934 億美元，較 2024 年成長達 21.0%，主要為人工智慧(AI)強勁需求帶動下，處理器、高頻寬記憶體(HBM)與網路通訊元件，正引領市場進入前所未有的成長期。

工研院產科國際所於 2025 年 12 月發表的預估報告指出，受惠電子終端需求溫和復甦以及 AI 與 HPC 應用帶動先進製程及先進封裝的爆炸性成長，2025 年整體半導體市場表現亮眼。隨著人工智慧(AI)應用、高效能運算(HPC)及終端裝置(PC、手機)換機潮持續發酵，先進製程將成為驅動半導體產業發展的核心動能。預估全球半導體市場在 2026 年將維持高成長趨勢，年成長率達 11.9%，市場規模上看 8,643 億美元，再創歷史新高。

台灣半導體產業鏈在全球地位重要，半導體先進製程領先全球，晶圓代工、封裝測試產值全球第一，IC 設計全球第二。2026 年台灣將藉由先進製程技術引領 AI、5G 及高效能運算領域發展，推動台灣半導體產業邁向新高峰，產值預估突破 7 兆元台幣，相較 2025 年增幅將達 10.0%。

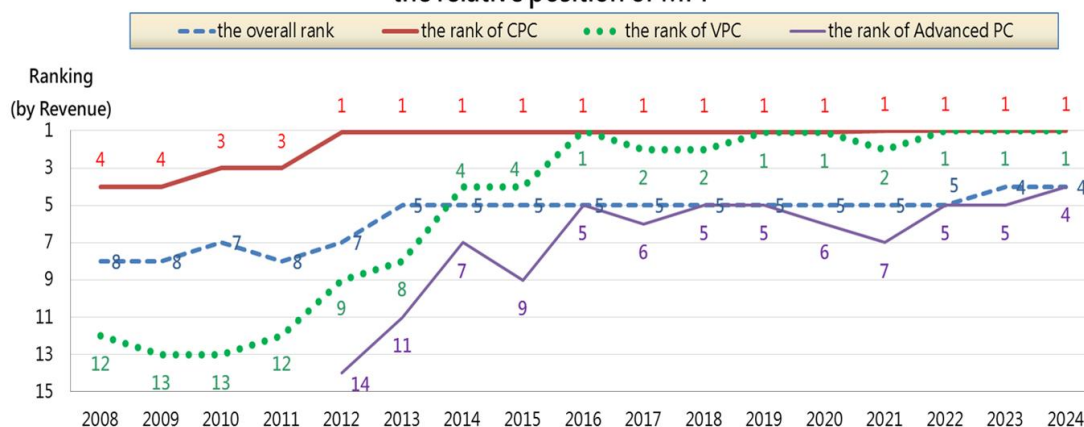
全球探針卡市場預測



資料來源：TechInsights(2025/05)；旺矽彙整(2025/05)

引用 TechInsights 2025 年 5 月公布的全球探針卡市場預測，2024~2029 年複合成長率(CAGR)為 9%，全球探針卡市場仍呈現穩定成長的樣態。

旺矽科技於全球探針卡市場之排名 the relative position of MPI



資料來源：TechInsights(2025/05)；旺矽彙整(2025/05)

TechInsights 2025 年 5 月公布的供應商調查報告，數據顯示旺矽科技自 2013 年躍升全球探針卡供應商總排名第 5 位之後，持續投入資源研發與拓展銷售，力求維持此一成績，並期望能以更優異的排名成績前進。旺矽科技在 2023 年全球探針卡總排名攀升至第 4 位；其中在懸臂式探針卡(Cantilever Probe Cards)市場中，旺矽全球市佔率排名第 1；在垂直式探針卡(Vertical Probe Cards)市場中，旺矽全球市佔率排名第 1；在邏輯 IC 測試探針卡市場中，旺矽市佔榮登全球第 3 名。

旺矽科技近年來無論是探針卡產值、抑或是全球排名方面，均逐年穩定向上攀升，在市場上已然奠定其領先地位；經營策略著重在研發投入及技術創新性，力求以更高階的技術持續其成長動能，以保有競爭優勢。

(b) 半導體設備

近年來產業發展趨勢圍繞於 AI 相關技術產品、車用感測器拓展與穿戴式產品延伸。在此架構下，半導體與化合物半導體元件技術同步升級，從材料、製程到封裝與測試皆出現結構性變化。其中不僅矽光元件持續演進，晶圓級封裝(WLP)、2.5D/3D 整合與異質整合技術亦快速擴展，同時帶動雷射、光感測器與其他光主動元件之高密度整合需求。

在 AI 產品技術發展方面，核心目標在於建構更高速傳輸之完整生態系統。隨著資料中心由 800G 邁向 1.6T 甚至 3.2T 世代，PIC (Photonic IC) 與 EIC (Electronic IC) 朝向高頻寬、低功耗與高整合度發展，並逐步導入 Co-Packaged Optics (CPO) 架構。此趨勢使電光協同設計 (co-design) 成為主流，同時要求封裝端具備低寄生電容、低插入損耗與高散熱能力。對應設備技術上，必須支援 >50GHz 以上之高頻點測能力，並具備低損耗 RF 探針設計、阻抗匹配控制與高穩定溫控平台，以確保高速訊號完整性。

在矽光晶圓測試方面，除傳統 DC 與 IV 量測外，更需整合混合訊號測試與高速 S-parameter 分析。端面耦合測試要求高精度六軸對位系統與主動式光功率回授控制，以達成微米級對準精度；光柵耦合則需搭配多通道平行量測與大面積掃描能力，提高晶圓級測試效率 (UPH)。設備端需同時兼顧電測與光耦合穩定性，並符合 SEMI 規範與量產自動化需求，才能在不同晶圓與封裝製程間提供一致性生產解決方案。

在 AI 驅動的化合物半導體應用上，EEL、EML、VCSEL、PD 與 uLED 等主動元件之量產規模快速擴張。技術層面上，除要求更高調變頻寬與更低相位雜訊外，對高速量測與低雜訊比 (Low SNR) 測試能力之需求亦顯著提升。設備必須支援高電流驅動與低雜訊電源架構，同時整合高速光電轉換效率量測與頻響分析功能。對於 uLED 與微型化元件，需具備微小電流精準控制與高解析度探針定位能力，以避免接觸誤差導致量測失準。

此外，車用感測器與 LiDAR 技術成熟亦帶動高功率雷射元件需求成長。VCSEL 一維與二維陣列之量測需支援大功率驅動、光束均勻度分析與熱分布監控，同時進行長時間可靠度與 Burn-in 測試。CW Laser 則需進行光功率穩定度、波長漂移與光束品質分析。設備端須整合高功率散熱模組、即時溫度回授控制與高速資料擷取系統，以滿足車用等級對穩定性與壽命之嚴格要求。

另外，uLED 延伸的顯示需求，已經擴及到 VR 與 AR 相關的顯示應用。除了單純的 LED 特性測試外，對應到顯示模組的特性分析，包含顏色、亮度、均勻度、發光場型等相關的驗證。對半導體設備而言，除了整合相對應的光學量測套件外，也需要提供對應的測試方案以符合不同的面板尺寸、解析度尺寸、以及相關的電測與光測介面。

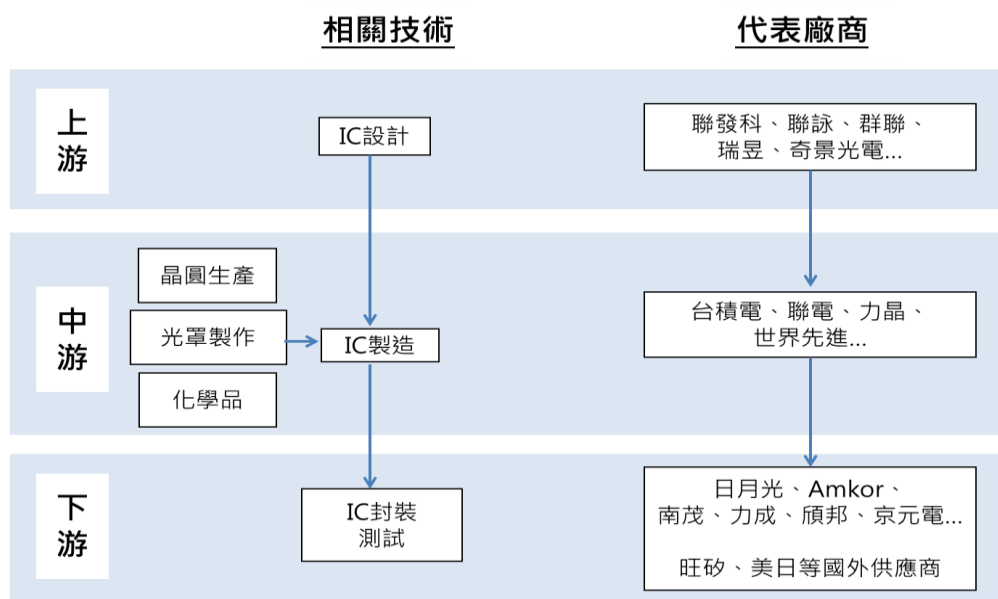
(2) 國內行業現況

(A) 晶圓探針卡(半導體產業)

半導體產業目前已是台灣重要的產業之一，在政府的推動以及業界多年的經營，形成半導體產業的完整供應鏈；台灣擁有完整產業結構以及專業分工體系，舉凡自上游的 IC 設計、中游的晶圓製造及下游的 IC 封裝、測試等，都有專業廠商投入。

2025 年台灣半導體產業在 AI 與 HPC 新興應用的帶動下，整體呈現加速成長態勢。IC 設計業受惠於高階智慧型手機、AI PC 陸續上市，加上通訊規格升級驅動換機潮，終端消費市場穩步回升。晶圓代工領域則以 AI 與 HPC 應用為核心成長引擎，推升營收大幅躍升。此外，隨著 AI 伺服器、AI PC、車用電子等終端裝置滲透率持續提高，市場對先進封裝的需求穩健增長，成為支撐 IC 封測業發展的關鍵動能。

半導體產業上中下游關聯圖



資料來源：旺矽

根據工研院產科國際所的統計，2025年第3季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新台幣16,697億元，較第2季成長4.4%，較2024年同期成長20.6%。其中，IC設計業產值為3,490億元，較2024年同期成長7.2%。而IC製造業為11,372億元，較第2季成長6.4%，較2024年同期成長26.8%。

資料顯示，2025年第3季IC製造業的晶圓代工產值來到10,806億元，較第2季成長5.7%，較2024年同期成長27.0%。記憶體與其他製造為566億元，較第2季成長21.2%，較2024年同期成長23.9%。而另外，IC封裝業為1,252億元，較第2季成長8.4%，較2024年同期成長12.4%。IC測試業則為583億元，較第2季成長4.5%，較2024年同期成長15.4%。

預估2025年台灣IC產業產值達6兆4,825億元，較2024年成長22.0%。IC設計業產值為1兆4,320億元，較2024年成長12.6%。IC製造業產值則是來到4兆3,401億元，較2024年成長26.9%。

IC製造業的晶圓代工產值，預估2025年達4兆1,362億元，較2024年成長27.5%。記憶體與其他製造為2,039億元，較2024年成長16.1%。另外IC封裝業為4,822億元，較2024年成長13.9%。IC測試業產值則為2,282億元，較2024年成長14.0%。

表、2025年台灣IC產業產值

億新台幣	25Q1	季成長	年成長	25Q2	季成長	年成長	25Q3	季成長	年成長	25Q4(e)	季成長	年成長	2025(e)	年成長
IC產業產值	14,888	-0.4%	27.6%	15,994	7.4%	25.9%	16,697	4.4%	20.6%	17,246	3.3%	15.4%	64,825	22.0%
IC設計業	3,620	8.4%	20.6%	3,595	-0.7%	15.0%	3,490	-2.9%	7.2%	3,615	3.6%	8.3%	14,320	12.6%
IC製造業	9,683	-2.8%	34.5%	10,686	10.4%	32.4%	11,372	6.4%	26.8%	11,660	2.5%	17.0%	43,401	26.9%
晶圓代工	9,261	-3.3%	37.2%	10,219	10.3%	34.4%	10,806	5.7%	27.0%	11,076	2.5%	15.7%	41,362	27.5%
記憶體與其他製造	422	8.2%	-5.0%	467	10.7%	0.2%	566	21.2%	23.9%	584	3.2%	49.7%	2,039	16.1%
IC封裝業	1,069	-3.7%	8.3%	1,155	8.0%	13.0%	1,252	8.4%	12.4%	1,346	7.5%	21.3%	4,822	13.9%
IC測試業	516	-2.4%	6.3%	558	8.2%	15.3%	583	4.5%	15.4%	625	7.2%	18.4%	2,282	14.0%
IC產品產值	4,042	8.4%	17.3%	4,062	0.5%	13.1%	4,056	-0.1%	9.2%	4,199	3.5%	12.6%	16,359	13.0%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,277	15.4%

註：IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業產值
 資料來源：工研院產科國際所(2025/12)

展望 2026 年在全球人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求將由爆發性成長轉入穩健擴張期，隨著應用端規格持續升級，半導體產業將迎來新一波成長高峰。台灣憑藉全球領先的先進封測能量及晶片異質整合技術，能精準滿足全球電子終端產品對於晶片高整合及高效能的嚴苛要求。IDC 預估，2026 年全球半導體封測將成長 11%，其核心動能來自 Edge AI 與 AI ASIC 的強勁滲透。對於高度仰仗半導體封測業的探針卡產業而言，終端應用衍生的高階封裝需求激增，帶動測試介面需求穩定成長，可望進一步刺激探針卡市場規模續創新高。

(B) 半導體設備

在半導體設備相關供應鏈上，台灣憑藉完整的晶圓代工(Foundry)、封裝與測試(OSAT)體系，以及成熟的製造自動化能力，已成為全球高階元件量產的重要樞紐。隨著歐美日客戶新產品開發(NPI)與量產導入需求增加，從試產驗證到大規模量產階段，皆需導入高自動化、高精度之半導體設備，以確保製程穩定性與良率控制能力。

在產品開發階段，工程用點測設備(Engineering Prober / Manual & Semi-auto Probe Station)仍為關鍵工具。隨著 AI 與高速通訊應用推進，高頻訊號量測能力成為核心技術門檻。設備需具備低損耗 RF 路徑設計、良好阻抗匹配、高頻探針卡整合與短訊號傳輸路徑設計。此外，光電整合元件(如矽光晶片、EML、VCSEL、PD)之開發，也要求點測平台能同時支援電訊號與光訊號量測，整合相關的光電量測儀器與溫控平台，實現電光同步測試的需求。

在顯示元件與微型化光電元件方面(如 Micro LED、uLED、感測器晶片)，探針技術需對應微小 Pad Pitch 與高密度排列結構。這使探針材料選擇、接觸力控制與針尖壽命管理成為關鍵。對應平台的定位精度、高穩定平整控制與自動對位視覺系統，以確保量測準確性與接觸重現性均至為重要。

進入量產測試階段，設備需求除單元件驗證外、高效率、多元件(Multi-site)平行測試能力。元件小型化與低功耗設計，使得量測電流範圍橫跨 pA 至 A 級電流，要求測試系統具備低雜訊電源模組與高速資料擷取等能力。同時，隨著光電訊號整合趨勢，量產設備需支援 DC、AC、高頻與光功率同步測試，並具備自動化分 Bin 與即時良率分析功能。

在自動化方面，設備需整合 EFEM(Equipment Front End Module)、自動晶圓搬送系統與 SEMI 標準通訊介面(如 SECS/GEM)，確保與客戶產線無縫接軌。對於歐美日客戶而言，設備穩定度、MTBF(平均故障間隔時間)與可追溯性(Traceability)亦為評估重點，因此系統架構需強化資料紀錄、遠端監控與製程參數回溯能力。

整體而言，隨著 AI、車用與行動裝置應用推動高速化、低功耗與電光整合發展，半導體設備供應鏈正朝向高頻化、微型化與平台整合化演進。台灣在製造體系與量產經驗上的優勢，使其在新產品導入與全球供應鏈重組過程中，成為高階自動化測試設備開發與落地的重要基地。

(B) 產業上、中、下游之關聯性

本公司目前之主要產品包括晶圓探針卡及半導體設備系列機種設備等，由於機械業加工過程複雜，所需零組件數量眾多，故於生產過程中部分零件加工係由協力廠商負責製造。就其所屬行業上下游關聯情形觀之，本公司係研發、設計組裝並銷售各式晶圓探針卡及機械設備予半導體及 LED(發光二極體)等產業之下游廠商，而上游則為零組件及原料供應體系，包括 PCB、探針、顯微鏡、滑軌及自動控制元件等供應商，茲將其產業相關之上、下游關聯性列示如下：

A. 晶圓探針卡：

上游	中游	下游
量測儀器業		
印刷電路板業	測試用探針	IC 設計產業

陶瓷板業	專用治具設備	IC 製造產業
合成樹脂製造業	晶圓探針卡測試設備	IC 測試產業
被動元件業		

B. 半導體設備：

上游	中游	下游
PCB 業	電腦	LED 產業
機械加工業	自動控制測試治具及設備	光電製造業
自動控制元件	探針	分離式元件業
量測儀器業		通訊業
電腦設備業		半導體晶圓測試產業
光學元件		
電子零件		

(C) 產品之各種發展趨勢

(1) 晶圓探針卡(半導體產業)

探針卡的發展與 IC 產業的電子封裝發展有高度關聯，目前如系統級封裝(System in Package, SiP)、立體封裝(InFO、CoWoS、2.5D、Chiplet& 3D IC Packaging)、扇外型封裝(Fan Out Packaging)、微機電與感測元件封裝(MEMS and Sensor Packaging)、矽光子、高頻測試等需求，均需仰賴不同的探針測試技術。IC 產業中對於封裝與測試階段的成本要求嚴謹，且伴隨 IC 製程技術演進，封裝與測試階段的技術要求也愈趨嚴苛。歸納出以下九項發展趨勢：

①針距細微化

半導體整體技術的演進，將持續朝電路間隔微小化前進。配合未來 IC 製程微縮及晶片面積持續縮小，構裝接合技術追求最短連接長度、最佳電氣特性、高輸出/輸入接點密度，以縮小 IC 尺寸，增加單位晶粒數量；晶圓探針卡勢必朝向更細微化之針距發展，以符合 IC 製程技術的要求。

②處理高速訊號干擾

晶片系統級封裝 (System in Package, SiP) 以及多晶片堆疊構裝系統已成為 IC 發展主流，SiP 封裝的成本仍高，因此多晶片堆疊封裝前，必須確認單一晶片良率無礙，以及堆疊的各種晶片都經過針測，確保良率後再行構裝，以避免後續額外支出。此些晶片系統級封裝 (System in Package, SiP) 以及多晶片堆疊構裝當中的高速訊號需處理相關訊號整合及電磁干擾問題(signal performance)，技術難度逐漸提升。

③處理熱效應問題

IC 產品適用的工作環境各不相同，故晶圓測試時，必須模擬產品使用環境(高低溫)進行測試，以確認溫度的衝擊不會影響 IC 產品電子電路的正常運行。

數款晶片測試時都需考慮熱效應或高低溫測試問題。High performance 晶片衍生的熱效應問題在晶圓測試階段、以及後段封裝階段影響甚鉅；此外，車用晶片需求漸增，也凸顯熱效應問題的重要性。有些類型晶片需要更長的晶圓測試時間、更複雜的晶圓測試環境，使得探針卡設計必須考慮到晶圓測試時的增溫、降溫問題與限制，及溫度效應造成的探針卡變異現象。

④高頻高速探針卡

高速 SerDes 介面(high speed SerDes interface)應用漸增，面對此類光纖傳輸通訊界面測試，光纖對位精度要求嚴謹，光通訊所需的測試也需仰仗新的測試方法。探針卡須開發新的設計，以克服目前光通訊測試面臨的瓶頸。

5G 通信、HPC、AI、車用電子、VR 無線傳輸、網路應用需求上揚，使高速通訊晶片需求大幅成長，甚至驅動 IC 也朝高速訊號傳遞發展。高速通訊晶片中最重要設計考量乃訊號之傳遞，所以訊號傳遞路徑的阻抗匹配、及訊號完整性都極其重要；如何進行探針卡的線路設計與製造精密度，以確保訊號傳遞之完整性，亦為探針卡的開發關鍵。

⑤多晶片平行測試

為節省測試時間與提升成本效益的一次接觸多晶片測試的策略，使得探針卡的設計難度激增。此外，要達到多晶片平行測試目的，設計晶片同測數要高，同測面積要大，並且達成DUT與DUT間的一致性，控制良好平面度…等，這些需求都須仰賴更好的探針卡設計製造技術。

⑥適用不同半導體材質與技術

對於半導體新製程技術的創新與開發，將衍生對應出不同類型的晶片焊墊（Bonding Pad）及焊墊材質。若待測晶片之接觸鉅墊材質不同，所需之探針卡技術亦將有所差異。

⑦低接觸電阻

為符合手持行動裝置減少耗電的需求，其操作電壓相對應會降低，而探針卡在測試晶片時的接觸電阻就不能太高。因此低接觸電阻探針卡，亦為設計開發之要點。

⑧少清針

探針卡的針尖接觸品質不佳時，將無法達到良好測試功能，必須加以清針才能繼續測試；但清針時，針尖會被磨耗，探針壽命會因此縮短。因此開發少清針之探針卡已成產品發展重點。

⑨高功率晶片測試

工業、通訊與網通設備市場對於高功率、高電壓的電源晶片需求迅速攀升，促使IC廠商廣泛布局相關產品；工業、通訊、網通設備對於高功率電源晶片需求的共通點在於高輸入電流，故開發適用於高功率晶片測試的探針卡，就非常重要。

(2) 半導體設備

①光電高速量測能力

在光主動元件領域，如 VCSEL、CW-DFB、EML、DML、Micro LED 等光通訊與光感測元件，除基本 DC 電性（IV、Leakage）與光性（L-I-V、光功率、波長）量測外，高頻與低雜訊射頻特性量測已逐步導入量產規劃。隨著資料速率提升至 25G/50G/100G PAM4 甚至更高階應用，需驗證元件之頻率響應（Frequency Response）、S-parameter、抖動（Jitter）、RIN（Relative Intensity Noise）及調變頻寬等關鍵指標。

因此，對應點測設備須具備：

- 40~70GHz 高頻傳輸能力
- 低插入損耗與阻抗匹配控制（50Ω RF Path）
- 高屏蔽設計與接地架構，降低 EMI 雜訊干擾
- 高穩定溫控平台，避免熱漂移影響量測結果
- 抗震動結構設計，確保高頻探針接觸穩定性

特別在晶圓級量測階段，微小震動或雜訊干擾皆可能造成量測誤差放大，因此設備結構剛性與電氣隔離設計已成為高速量測平台的核心能力。

②光學耦合精密度

在矽光子元件及其後段製程中，光輸入與輸出介面多透過光纖陣列（Fiber Array）進行耦合。隨著通道數量增加（如 8ch、16ch 甚至更高密度）以及多波長應用發展，光耦合效率、重現性與對位速度成為量測與生產的關鍵技術。

主要技術挑戰包括：

- 微米甚至次微米級六軸對位精度
- 主動式光功率回授對準（Active Alignment）
- 多通道同步最佳化演算法
- 降低插入損耗與提升耦合一致性

此外，在端面耦合與光柵耦合的發展下，設備需兼具高解析能力與高速掃描功能，以縮短單顆晶片耦合時間並提升 UPH（Units Per Hour）。

③自動化生產

隨著人力成本持續上升，以及客戶對品質一致性與可追溯性的要求提高，光電元件產業正逐步比照半導體產業模式，導入高度自動化之生產設備與製程流程。從工程樣品驗證轉向量產導入階段，自動化已成為標準配置。

多站點分散式測試設備 (Multi-site Distributed Testing) 可在最小占地空間內實現最高產能，透過平行測試架構提升測試效率，並降低單顆測試時間對整線產出的影響。同時，設備需整合：

- EFEM 與自動晶圓搬送系統
- FOUP 對接與 SEMI 標準通訊協定
- 無人化倉儲與 AMHS 自動傳輸系統

藉由自動化上下料、即時資料回傳與自動分 Bin 功能，可達成高效率與高一致性的生產需求。

④生產管理與整線優化

除單站機台產出效率外，整線產出效率 (Line Throughput) 與設備稼動率 (Utilization Rate) 已成為製造端的重要評估指標。如何透過資料流整合與製程最佳化設計，提高整體生產效率，是設備發展的重要方向。

未來設備設計需結合：

即時製程資料收集 (Real-time Data Logging)

良率分析與 SPC 統計控制

MES 系統整合與製程追溯功能

透過數據驅動的生產管理架構，不僅可降低異常停機風險，亦能優化測試節拍與資源配置，使整線達到最佳化運行狀態。

(D) 產品之競爭情形

主要競爭對手名稱及其營業項目或競爭項目

(1) 晶圓探針卡

根據 TechInsights 調查，旺矽科技為國內專業晶圓探針卡龍頭製造商，在台灣探針卡供應商當中，旺矽科技是唯一名列前四名的探針卡廠商。主要競爭對手是來自於國外之大廠。

同業廠商	競爭產品
台灣傑睦股份有限公司 (日商 JEM 在台設立)	晶圓探針卡
美亞科技股份有限公司 (Nidec SV TCL 集團之台灣分公司)	晶圓探針卡
美商福達電子股份有限公司 (美商 FormFactor 分公司)	晶圓探針卡
特諾本科技有限公司 (義大利商 Technoprobe 集團之台灣分公司)	晶圓探針卡

(2) 半導體設備

本公司的半導體設備率先以自有品牌與卓越技術能力，取得客戶的高度認同。隨著光電產業逐漸的成長，越來越多國產設備廠商投入相關的半導體設備開發。本公司憑藉著自有技術能力、以及顧客至上的服務精神、搭配充沛產量的支援，在如此高度競爭的市場仍能保持第一領導品牌的地位。茲就相關競爭廠商說明如下：

同業廠商	競爭產品
OPTO tech. Co., Japan	晶圓針測機 晶粒挑揀機
惠特光電股份有限公司	晶圓針測機
致茂股份有限公司	晶圓針測機
Cascade, USA	晶圓針測機
豪勉科技	晶圓針測機

維明科技有限公司	晶圓針測機 晶粒測試儀
矽電科技, 中國	晶圓針測機
柯泰科技, 中國	VCSEL 測試系統
菲萊科技, 中國	VCSEL 測試系統

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	114 年度	截至 115 年 3 月 31 日
研發費用	1, 276, 200	322, 982

2. 最近五年度開發成功之技術或產品

年 度	技 術 或 產 品 名 稱
114	應用於 3D 封裝製程之超微間距凸塊(u-bump)測試探針卡開發計畫 工程用雙面矽光晶圓點測設備 自動測試設備介面的單元件自動化點測設備
113	AI 晶片之高速測試用探針卡(224Gbps PAM4)開發計畫 應用於高效能運算處理器 IC 測試之高針數微機電探針卡開發計畫 高精度、高抗震 AVI 檢測平台 高速 PAM4-100G 元件光雷射頻特性量測系統 皮安等級 (pico level)光強度、低電流量測系統 晶粒等級 (chip level)與封裝體(package level)矽光子元件測試與 自動化挑檢系統
112	應用於高階智慧型手機應用處理器 IC 測試之大面積、高針數微機電探 針卡開發計畫 車用 IC 測試之大面積微機電探針卡開發計畫 高效能運算 IC 之高速測試用探針卡(112Gbps PAM4)開發計畫 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓 級測試系統 化合物半導體量產自動化設備
111	先進 CoWoS 封裝之資料中心(HPC)應用處理器測試用垂直式探針卡開發 計畫 微間距(70um)全陣列微機電垂直式探針卡開發計畫 自動可調探針間距之高階載板阻抗測試設備開發計畫 Micro LED 多通道高速低電流量測設備 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓 級測試系統 化合物半導體量產自動化設備
110	微間距(80um)全陣列微機電垂直式探針卡開發計畫 低階測試機實現高速訊號(≥ 2.5 Gbps)測試之高速模組探針卡開發計 畫 結構強化微間距垂直式探針卡開發計畫 8 吋 Micro LED 晶圓級多站點分散式光電測試系統 奈秒脈衝等級之高功率雷射二極體 (Laser Diode、VCSEL) 之晶圓 級測試系統

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 長期業務發展計畫
 - (1) 開發美國市場，以支援客戶之需求
 - (2) 應用累積之技術及人才向電子測試領域做水平發展
 - (3) 培育國際化分工產銷之人才與能力
 - (4) 持續多方面改善企業體質
 - (5) 催化國內薄型化晶片應用
 - (6) 未來料源充足時，延展長晶廠之業務觸角
2. 短期業務發展計畫
 - (1) 強化人才培訓
 - (2) 市場拓展行銷
 - (3) 建立各部門日常管理制度，落實部門管理

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區以台灣為主，其他銷售地區也擴及美國、日本、歐洲及中國。目前國內主要的晶圓代工廠商(Foundry)、IC 設計公司(Fabless)與封裝測試廠(OSAT)都是本公司客戶。

2. 市場占有率

旺矽科技專精於半導體晶圓測試用探針卡設計與製造，為國內第一大廠，跟國內同性質競爭業者相較，舉凡產能、研發製造能力、財務結構均最完整。

國際專業市調機構 TechInsights 於 2025 年 5 月公佈的 2024 年全球晶圓探針卡調查報告中指出，於全球探針卡公司總排名中，旺矽科技位居全球排名第 4 位；在懸臂式探針卡以及垂直式探針卡市場中，旺矽科技更是穩坐全球第 1 大探針卡供應商。

在國內，旺矽科技乃探針卡市場之業界龍頭，產品內容涵蓋整體探針卡、懸臂式、垂直式、LCD 驅動 IC、高頻高速、微機電探針卡，且無論是品質或是銷售量，皆為國內同業之指標。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 需求方面：

台灣產業聚落完整，上下游供應鏈完善，是台灣半導體業的競爭優勢。在 IC 構裝體積日漸縮小，構裝成本提高的趨勢下，晶圓針測已是 IC 製程中重要關鍵的一環，故晶圓探針卡需求量與 IC 製造量之間有一定相互關係。

近年來由於各式消費性電子產品的功能愈複雜及多樣性，加上 5G 通訊、高效能運算(HPC)、汽車/工業與 AI 等應用領域發展趨勢，使得消費者除了要求各項產品要輕、薄、短、小之外，對於功能性的需求愈高；國內外半導體市場之領導廠商為提高產業佔有率，仍持續增加資本支出，擴充產能；隨著晶片量產數量的提升，加上晶片之封裝技術趨勢朝向薄型化、低系統成本、高效能發展，對於晶圓針測的要求也越趨嚴謹。

台灣晶圓代工業位居全球第一，台灣封測業高居全球第一，IC 設計業居全球第 2，僅次於美國；半導體產業聚落完整已然是台灣半導體業的競爭優勢。

封測業與 IC 製造、IC 設計業同步成長，都是驅動台灣半導體產業不斷成長的動能。由於探針卡主要應用於晶圓良率檢測，晶圓代工業的發展可期，預計也將激勵探針卡市場的成長。而探針卡的設計越益複雜，更加重半導體產業對於探針卡的品質與數量之需求。

(2) 供給方面：

全球探針卡市場高度競爭，各探針卡廠商有其專精擅長的產品技術與合作的客戶，例如國外某些廠商對於記憶體掌握度較高。在國內市場已是龍頭地位的旺矽科技則專精

於懸臂式、LCD 驅動 IC、垂直式和高速高頻率的探針卡，目前國內大部分廠商均已與旺矽長期合作的客戶，旺矽科技駐足台灣、關注台灣產業技術變化之外，也積極布局國外各主要區域，力求探針卡產品可滿足市場需求。

技術能力方面，旺矽在高腳數、狹間距、高速高頻率的製作技術已相當成熟，居市場領先地位，並已建立一定的技術門檻；探針卡產品包含懸臂式(Cantilever)、垂直式(Vertical)和微機電式(MEMS)探針卡，不論是一般型或高頻測試用探針卡，旺矽科技已具備能力可自行提供，加上產品兼具微間距、同測數高的優點，可節省晶圓測試成本、提升針測精準度。旺矽未來仍將秉持技術創新的理念，持續投入下一代的高階先進式探針卡的研發工作。

4. 競爭利基

- (1) 提供卓越穩定的技術與產品，多年來已與客戶培養穩定之合作關係。
- (2) 提供 Total Solution，搭配即時客戶服務與相關領域的應用 Know-how。
- (3) 持續創新：面對技術不斷提升的科技產業，滿足產業對新技術的應用與需求，旺矽科技除了持續投入相當多的研發資源進行技術研發以確保領先地位之外，近年都投入大量之研發經費做技術開發，特別是新技術之開發，以確保公司未來之競爭力，打造技術壁壘。在先進式垂直式探針卡市場，目前已直接跟國外 IC 設計公司接洽，從中建立起緊密合作關係，並投入大量研發資源，以確保未來之成長性。
- (4) 完整的專利佈局：提出申請的專利數共計 1,575 件，獲證(公開)之專利權共 1,141 件(統計至 2025 年底)。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- (a) 產品品質及穩定性已獲國內外半導體大廠之認可，目前已成功打入國際大廠供應鏈，更是國內公認最佳供應商。
- (b) 具備完整、多元的研發能力和人才，對於未來產業之趨勢發展，能做審慎、完整的佈局。
- (c) 市場需求日漸趨向高腳數、狹間距與高速傳輸訊號的設計，本公司在此領域產品的品質和穩定性具高度競爭力，市場需求擴大，可望帶動本公司營收。
- (d) 完整的產品線：本公司以自動化的核心技術，不斷建立各項自動化應用技術。產品可因應需求，快速設計更換，適用於半導體產業中各相關產品測試，故可大幅降低單一產業景氣變動影響的風險。
- (e) 敏銳的市場掌握能力：擁有完整的銷售及服務通路，可即時反應市場狀況，作為回饋，確保競爭力。

(2) 不利因素

- (a) 小規模廠商為求生存而殺價競爭，增添市場價格變動的風險。
- (b) 傳統式晶圓探針卡市場成長有限，因此需持續開發微機電式、垂直式探針卡技術，以滿足先進式封裝大幅成長的需求。
- (c) 自動化測試設備的精密機械零件，大部分需自國外進口，取得成本高且交期長，在台灣客戶交期需求上存在風險。

(3) 因應對策

- (a) 提升晶圓探針卡製造品質，並縮短交期，以滿足客戶需求，爭取合理價格。
- (b) 積極投入資源進行技術研發，以因應新的技術挑戰，確保技術領先地位。
- (c) 加強測試設備之業務及市場研究，以提高對市場需求預估之準確性，並依市場需求，訂定進口零組件之安全庫存量，並建立半成品庫存制度，進而確保交期無虞。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

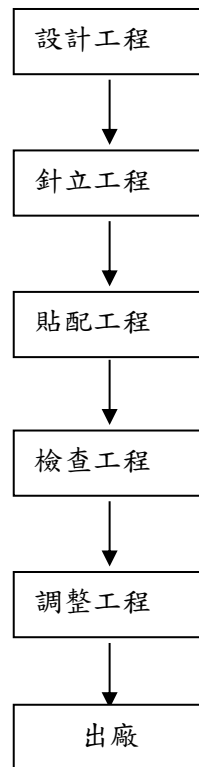
(1) 主要產品之重要用途：

產品或服務	主要用途或功能
-------	---------

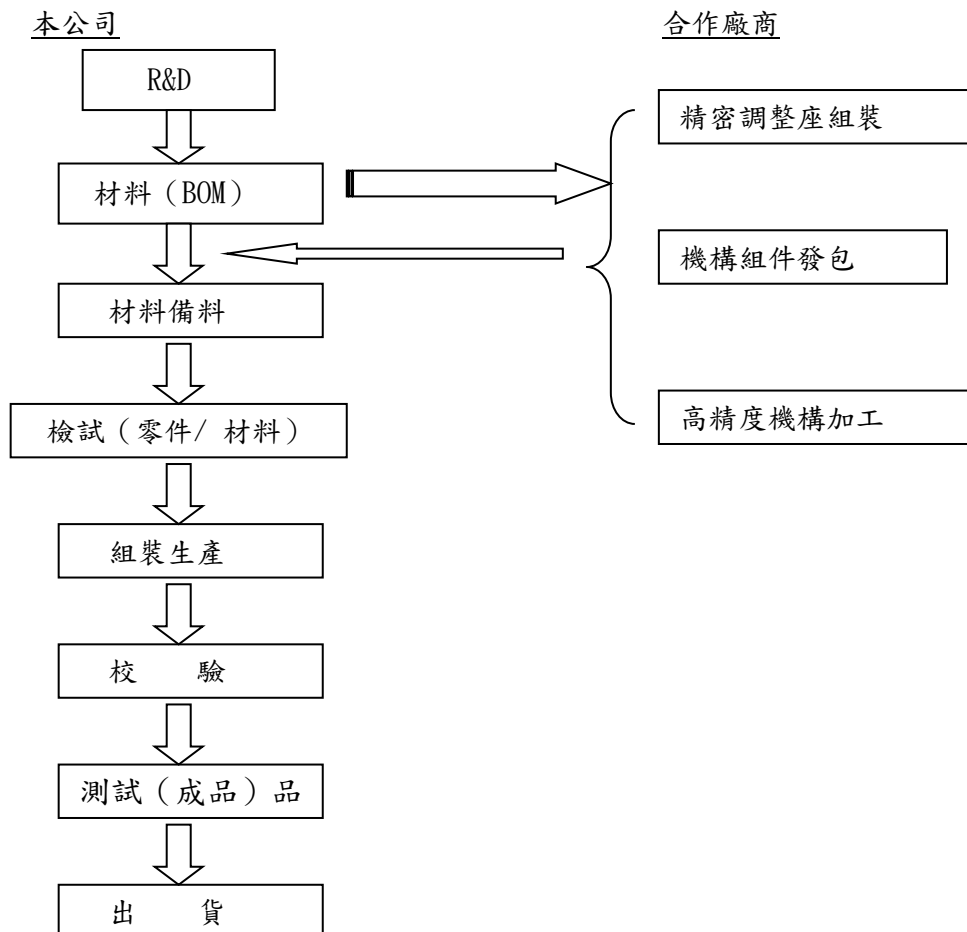
晶圓測試用晶圓探針卡	晶圓測試階段的量測介面，為待測晶圓與測試機台之間的橋樑，廣泛應用於邏輯元件、記憶體元件及 LCD 驅動元件晶圓級測試。
LCD Driver IC Final Test 測試用晶圓探針卡	屬封裝後的測試介面，為待測 LCD Driver IC、Tape 與測試機台之間訊號傳輸的橋樑。
垂直式探針卡	晶圓測試階段的量測介面，針對晶圓級針測及覆晶式產品需求所設計。
微機電式探針卡	晶圓測試階段的量測介面，針對晶圓級針測及覆晶式產品需求所設計。
半導體晶粒測試設備	光電半導體晶圓製作完成後，測試晶粒之光電性特性，並進行資料分 Bin。
半導體晶粒測試分選設備	光電半導體晶粒測試完成後，依晶粒之光電性特性，進行分類挑檢用。
全自動 AOI 檢測設備	光電半導體檢測與分選後，以自動光學檢測 AOI 的方式，將外觀不良的晶粒與以標示與分類的設備。

(2) 產品之產製過程

(a) 晶圓探針卡



(b) 半導體設備



(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品分為晶圓探針卡及半導體設備，晶圓探針卡其所需之原物料為 PCB、探針、套管等；半導體設備其所需之原物料為顯微鏡、機械車床、機械銑床、螺桿軌道、馬達、工業電腦等，本公司與國內外原物料廠商維持良好之合作關係，且關鍵材料、零組件均維持兩家以上的供應商，以保持採購彈性及分散原物料過於集中之風險。

(四) 主要進銷貨客戶名單

(1) 最近兩年度佔進貨總額 10% 以上之廠商名單

單位：新台幣仟元

113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
其他	2,346,002	100.00%	非關係人	其他	3,559,855	100.00%	非關係人	其他	1,304,811	100.00%	不適用
			不適用				不適用				
進貨淨額	2,346,002	100.00%		進貨淨額	3,559,855	100.00%		進貨淨額	1,304,811	100.00%	

增減變動說明：本公司 113 年度及 114 年度無佔進貨淨額 10% 以上之廠商。

(2) 最近兩年度佔銷貨總額 10% 之客戶名單

單位：新台幣仟元

113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
其他	10,171,861	100.00%	不適用	o 客戶	2,047,705	15.31%	不適用	其他	3,933,067	100.00%	不適用
				其他	11,323,476	84.69%					
銷貨淨額	10,171,861	100.00%		銷貨淨額	13,371,181	100.00%		銷貨淨額	3,933,067	100.00%	

增減變動說明：本公司 113 年度無佔銷貨淨額 10% 以上之客戶；114 年度 o 公司為佔銷貨淨額 10% 以上之客戶。

三、從業員工資料

最近二年度及截至年報刊印日從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 4 月 30 日
員工 人數	間 接 人 員	907	949	960
	直 接 人 員	942	1,097	1,150
	合 計	1,849	2,046	2,110
平 均 年 歲		38.1	38.2	38.2
平 均 服 務 年 資		9.33	9.18	9.78
學歷 分布 比率 (%)	博 士	0.32	0.20	0.24
	碩 士	16.98	16.72	16.35
	大 專	68.04	68.33	68.48
	高 中	14.06	14.27	14.50
	高 中 以 下	0.60	0.48	0.43

四、環保支出資訊

(一) 本公司通過環境管理系統(ISO14001)之驗證,有效期限為 2025 年 9 月 20 日至 2028 年 9 月 19 日,透過系統運作,檢視各流程對環境之影響,進而檢討及持續改善。公司設置支援服務部負責統籌、維護並持續改善環境管理系統,亦負責對外部及內部溝通環境之相關議題。由於公司產品特性,其製造過程對環境的衝擊甚微,主要的污染物類別為廢棄物及空污與廢水,惟公司重視各項污染防治工作,為減少環境衝擊,仍致力於投資設置污染防治設備,期使在有效管理下,使污染之影響日益減少,經由對各作業活動之盤查,以及同仁在活動過程之環保意識提升,建立年度改善計畫,進行廢棄物與空污與廢水的管控及減量,以達到污染預防、減少環境衝擊之承諾。

1. 依法令規定,應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者,其申領、繳納或設立情形之說明:
 - (1) 據環保法規,本公司竹北二廠、新埔廠及湖口廠申領取得水污染防治許可證及固定污染源操作許可證;並設有乙級廢水處理專責人員及甲級空氣污染防制專責人員。
 - (2) 依據環保法規辦理污染防治費用申報及繳費。
2. 公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益:污染防治設備用於製程廢水及廢氣之處理,減少環境污染、符合環保法令。
3. 最近年度及截至年報刊印日止,公司改善環境污染之經過,其有污染糾紛事件者,並應說明其處理經過:本公司最近年度及截至年報刊印日止並無環境污染情事。
4. 最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容),並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實:本公司最近年度及截至年報刊印日止並無此情事。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位或資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出:無。
6. 因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)相關資訊:依本公司行業特性,不受其影響,故不適用。

(二) 本公司使用能源有超過 95%來自外購電力，因此公司致力於電力減量，針對特定廠區之主要耗能設備如冰水主機等建立中央監控智慧節能系統，檢視其使用狀況與異常偵測，並配合政府節能政策，針對契約容量超過 800KW 的廠區設定年節電 1%的目標，近三年來達成平均節電率為 1.29%，節電總度數達到 158 萬度。

(三) 本公司 2022 年起推動組織溫室氣體盤查作業，並以 2022 年為基準年，於首年度建立本公司全廠區溫室氣體盤查管理制度，並於 2023 年 10 月完成 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查查證，後續規劃將配合政府政策研擬溫室氣體減量，以求達成排放減量目標。

五、勞資關係

(一) 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施：

本公司各項福利措施之擬定及推展，主要係為確保員工工作之安全與健康，藉由員工組成職工福利委員會之組織運作，使得同仁更樂於參與實際活動規劃與執行，促使各項活動更為出色、更為實際，以期達到調劑身心的目的。公司亦能體認員工係公司成長之重大動力，除上述組織運作辦理員工福利事宜外，另有相關福利措施如下：

- (a) 優渥的年薪，生活品質的提昇
- (b) 端午節、中秋節、年終獎金及三節禮券
- (c) 依工作績效給予員工酬勞，利潤共享
- (d) 定期依工作績效調薪
- (e) 依工作績效給予績效獎金
- (f) 提供國內外旅遊、購書、休閒娛樂活動等津貼
- (g) 優於勞基法之有薪彈性調整假
- (h) 公司自設餐廳，免費提供伙食，用心照顧同仁健康
- (i) 每年免費健康檢查，每月兩次專業醫生駐廠提供同仁免費健康諮詢
- (j) 提供宿舍補助、免費汽機車停車場、健身房、韻律教室等
- (k) 舒適的圖書空間並供免費借閱書報雜誌
- (l) 免費取用自助沖泡咖啡及茶包，代售優惠票券
- (m) 婚喪喜慶及生育補助
- (n) 完善教育訓練
- (o) 勞工保險、健康保險、團體保險、勞工退休金
- (p) 員工持股信託

114 年員工福利措施實施情形：

旅遊活動項目	補助人數	補助金額
員工旅遊補助	1, 115 人	19, 118, 305 元

其他活動項目	參與人數
牌藝大賽	114 人

麵食區之命名徵選活動	1,196 人
造山者電影欣賞	350 人
造山者電影欣賞(加映場)	85 人
旺矽好聲音	967 人
旺矽科技保齡球	174 人
國內員工旅遊	514 人
中秋禮品	2,006 人
紅包袋	2,058 人
年終晚會	2,066 人
外租羽球場地	905 人
圖書館書報雜誌	2052 人
動畫次元《出來吧，神龍！》親子音樂會	78 人
新竹交響管樂團風火祭《風的傳說》劇場	114 人
2025 與大師的邂逅《經典聖樂系列一》天主教篇	57 人

(2) 進修、訓練制度與其實施情形：

本公司由人力資源部的專門人員進行安排、規劃課程(包含公司委託其他單位、機關協辦之訓練課程)等專業職能的教育訓練，配合公司營運方針及發展目標，提升所有員工之素質、充實基礎知識、並增進工作技能，以發揮員工潛在之能力，及配合法令之宣導。公司教育訓練體系分為內部訓練、派外訓練、出國研習等，以滿足員工自我實現的個人需求。

114 年員工進修與訓練情形：

項目	班次數	總人次	總時數	總費用
1. 新進人員訓練	5	369	2,170	0
2. 專業職能訓練	290	2,314	8,036.5	2,106,014
3. 主管才能訓練	6	67	1,166	562,830
4. 通識訓練	199	5,594	7,438	160,215
5. 自我啟發訓練	14	238	1,782	898,251
合計	514	8,582	20,592.50	3,727,310

(3) 退休制度與其實施情形：

退休--適用選擇舊制者

本公司依政府相關法令按月提撥勞工退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會，綜理有關退休作業事項。

同仁有下列情形之一者，得自請退休：

- 一、工作年資滿十五年以上，且年齡滿五十五歲以上者。
- 二、工作年資滿二十五年以上者。
- 三、工作年資滿十年以上，且年齡滿六十歲者。

員工有下列情形之一者，得強制退休：

一、年齡滿六十五歲者。

二、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由事業單位報請中央主管機關予以調整。但不得少於五十五歲。員工退休年齡之認定，以戶籍記載為準，自出生日起實足計算。

員工退休金之給予標準規定如下：

一、工作年資每滿一年給與兩個基數，超過十五年之年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。其餘年資，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。

二、依本規則第六十一條第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依前款之規定加給百分之二十。

員工退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資；平均工資係指退休當日前六個月內所得工資總額除以六。

計算平均工資時，下列各款期間之工資及日數不列入計算：

一、員工退休之當日。

二、因職業災害尚在醫療中者。

三、女性員工到職未滿六個月因產假停止工作期間，其薪資減半發給者。

四、公司因天災、事變或其他不可抗力因素需停止，致員工未能工作者。

五、員工因普通傷病或留職停薪致薪資折半發給或不發給之期間。

退休金之給付應自員工退休之日起三十日內給付之。

勞工請領退休金之權利，自退休之次月起，因五年不行使而消滅。

其餘有關退休事項，依本公司員工退休辦法及勞動基準法規定辦理。

退休—適用選擇新制者

本公司依政府訂定之勞工退休金條例，按月提撥勞工退休金，並成立勞工退休準備金監督委員會，綜理有關退休作業事項。

勞工退休金之收支、保管、滯納金之加徵、罰鍰處分及其強制執行等業務，由中央主管機關委任勞工保險局辦理之。

勞退新制施行後，仍服務於本公司者，其適用新制前之工作年資，暫時予以保留，當勞動契約符合勞動基準法各項退休規定時，本公司依各法規定，以契約終止時之平均工資，計給該保留年資之資遣費或退休金。

本公司每月負擔之勞工退休金提繳率，不得低於勞工每月工資百分之六。

勞工退休金自員工到職之日起提繳至離職當日止。

員工留職停薪、入伍服役、因案停職或被羈押未經法院判決確定前，本公司應於發生事由之日起七日內以書面向勞保局申報停止提繳其退休金。

退休金之領取及計算方式如下：

一、94年7月1日後始到職或離職後再受僱者，依法均應適用勞退新制，年滿60歲（不限工作年資）即得向勞工保險局請領適用勞退新制期間個人專戶累積之退休金。

二、月退休金：勞工個人之退休金專戶本金及累積收益，依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，作為定期發給之退休金。

三、一次退休金：一次領取勞工個人退休金專戶之本金及累積收益。依本條例提繳之勞工退休金運用收益，不得低於當地銀行二年定期存款利率；如有不足由國庫補充之。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
如何提撥	按員工每月薪資總額 2% 提撥退休基金，以勞工退休準備金融監督委員會之名義專戶儲存於臺灣銀行。	依員工每月薪資之投保等級提撥 6% 至勞工保險局員工個人帳戶。
提撥金額	截至民國 114 年 12 月 31 日止，本集團撥存於臺灣銀行勞工退休準備金專戶之餘額為新台幣 134,730 千元。	民國 114 年度本集團提撥退休金為新台幣 113,265 千元。

(4) 勞資間之協議情形：

本公司屬勞動基準法適用行業，一切運作皆依勞動基準法為遵循基準，勞資關係和諧。

(5) 與員工權益維護措施：

本公司本著盈餘分享員工的理念，於章程上明訂員工分紅比率，以激勵員工參與熱誠。並設置「意見提案箱」推行提案制度，凡任何有助於公司管理或制度或設施等改進方法或意見皆可提議，為鼓勵員工踴躍提案，依其影響程度發給不等之獎勵金，以提供員工工作及生活上之溝通與意見交流的橋樑。

(6) 工作環境與員工人身安全保護措施：

建構安全環境，在大門出入口有 24 小時保全人員守衛，各出入口設有門禁管制及監視錄影系統，停車場設有緊急求援按鈕；建築物、消防器具、電氣設備、飲用水、電梯等各項設備，定期進行檢查及維護，以保障員工人身安全。

本公司通過職業安全衛生管理系統(ISO45001)之驗證，有效期限為 2025 年 9 月 1 日至 2028 年 08 月 31 日。由勞工安全專責部門及人員規劃執行及監督相關作業、教育訓練及內外部的溝通。並依照職業安全衛生法，設置職業安全衛生委員會，定期每三個月召開會議，以落實員工之安全衛生管理，進而保障員工安全與健康。另訂有勞工安全衛生、緊急應變、承攬商安全衛生、勞工安全衛生工作守則等災害防止管理辦法，每個月辦理自動檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練，以提升同仁對於工作環境的危害認知及緊急應變能力，並確保緊急應變計畫運作之執行的有效性。

對於工作場所中可能影響員工安全或健康之因素，公司亦定期安排清潔、消毒、作業環境測定與巡查，並且提供同仁每年享有免費的健康檢查、安排醫師到廠健康諮詢服務與辦理健康促進活動，讓員工擁有安全舒適的工作環境。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分

內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：由於本公司勞資關係良好，雙方溝通管道順暢，並無未來可能之糾紛支出。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

管理架構

本公司在總經理帶領下，成立資訊安全委員會及指派公司跨處室之資訊安全代表，致力於資安事項，並於2015年起取得ISO27001資安管理架構合格認證至今，目前證書有效期間113年11月16日至116年11月16日，持續精進資安制度與資安防護工具。

114年度執行情況，由總經理擔任資訊安全組織召集人，指派管理代表負責資訊安全管理系統運作，由管理代表向召集人與資訊安全委員會報告執行內容，包含年度資安管理系統運作執行狀況與計劃、以及其他建議或臨時動議。

114年度專責資安人員定期召開資安會議23次(固定於每雙週向管理代表報告)，資安管理審查會議召開1次，董事會資安運作成效會議召開1次，審查資訊安全發展方向及策略，使資訊安全管理制度持續穩健運作。近期資安治理報告已於115年1月12日董事會報告在案。

資安政策

1. 確保公司營業秘密(Trade secret, Business secret)及重要客戶資料之機密性。
2. 確保核心營運作業之資訊應用及支援服務與設備之可用性與完整性。
3. 確保資訊安全管理機制之有效性及持續性

公司為確保企業之永續發展與履行客戶承諾茲訂立公司之資訊安全政策，作業程序及辦法，以健全資訊風險管理，強化資訊安全管理機制，落實資訊安全防護，提升資訊安全之水準，並使公司各處室相關人員及重要合作夥伴有所依循。

資安管理方案

資訊安全具體管理方案如下：

1. 資訊架構檢視

(1)檢視對於持續營運所採取相關措施之妥適性

檢視相關措施之架構與維運機制是否存在單點失效之風險，及針對業務持續運作之妥適性進行風險分析，並提出資訊架構安全評估之結果與建議。

(2)檢視單點故障之最大衝擊與風險承擔能力

評估衝擊是否在風險承受度內，研議與執行改善之方案。

2. 網路活動檢視

檢視設備之存取紀錄及帳號權限

檢視網路設備、資安設備及伺服器之存取紀錄、帳號權限之授予與監控機制是否符合內控作業規範；以最小權限原則清查該等設備之帳號權限及存取紀錄，識別異常紀錄與確認警示機制。

3. 網路設備、伺服器及終端機等設備檢測

弱點掃描與修補作業

定期或適時辦理網路設備、伺服器及終端機的弱點掃描，並針對所發現之弱點進行改善、修補作業。評估弱點掃描作業之範圍、作業模式及弱點改善計畫與修補情形，針對掃描結果提出評估建議，重點在於找出架構中可能存在的弱點與漏洞，予以改善及修補，降低整體之資安風險。

4. 安全設定檢視

伺服器安全性原則設定

檢視伺服器(如：網域服務 Active Directory)有關「密碼設定原則」與「帳號鎖定原則」之設定，透過工具分析及人工作業，檢視相關網域安全性原則設定是否符合內控規範。

5. 網路詐騙防護 Internet Fraud Attack Protection

(1) 透過不斷的宣導來提醒同仁注意網路詐騙訊息。

(2) 實際的教育訓練來加強同仁對網路訊息的警覺心與辨識真假網路訊息的能力。

主要在於讓同仁瞭解電子郵件詐騙之風險，提高同仁防範社交工程詐騙之危機意識，以降低社交工程詐騙可能造成之風險與損失，進而達到保護客戶資料及重要營運資訊與服務之目的。

6. 資安事件通報與追蹤改善

本公司資安事故之通報與處理，皆有程序規範進行。

(1) 同仁發現資安事件，向委員或申訴信箱舉報。

(2) 資安事件應變小組，調查與確認資安事項，並出具改善措施與資安處理報告書。

(3) 資安事件若情節重大且影響公司競爭力或財務狀況，需立即採取因應措施將損害降到最低。

有鑑於新型態的資安威脅，如勒索軟體、社交網路攻擊、電子郵件詐騙等威脅日益增多，透過調整及提升內外網路連線防護，落實備份，並定期安排弱點掃描與滲透測試，加強人員資安意識，全面提升資安防護能力。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃	長洛國際股份有限公司	108.01.01 ~ 108.12.31 (到期自動延長)	分租新竹縣新埔鎮文山路廠辦大樓及停車位	無
長期借款	台北富邦銀行-總行	114.02.17 ~ 121.02.17	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	台北富邦銀行-總行	114.05.19 ~ 121.02.17	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	台北富邦銀行-總行	114.07.31 ~ 121.02.17	土地及建築物抵押借款	無
長期借款	彰化銀行-城內分行	112.07.26 ~ 132.07.26	土地及建築物抵押借款	無

代理	長洛國際股份有限公司	100.01.01 ~ 未明訂 (若雙方未同意終止本契約，則視為繼續有效)	半導體相關設備之獨家代理銷售	無
----	------------	--	----------------	---

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		13,317,607	9,505,177	3,812,430	40.11%
不動產、廠房及設備		7,729,355	4,561,432	3,167,923	69.45%
使用權資產		583,238	145,017	438,221	302.19%
無形資產		581,270	318,306	262,964	82.61%
遞延所得稅資產		164,257	165,252	-995	-0.60%
其他非流動資產		861,913	1,405,750	-543,837	-38.69%
資產總額		24,002,834	16,478,513	7,524,321	45.66%
流動負債		7,569,357	5,673,260	1,896,097	33.42%
非流動負債		1,854,874	1,498,303	356,571	23.80%
負債總額		9,424,231	7,171,563	2,252,668	31.41%
股本		979,813	942,311	37,502	3.98%
資本公積		5,165,644	1,744,545	3,421,099	196.10%
保留盈餘		8,211,708	6,543,703	1,668,005	25.49%
其他權益		221,438	72,171	149,267	206.82%
權益總額		14,578,603	9,306,950	5,271,653	56.64%

(一) 增減比例變動分析說明：(增減變動比例達20%以上且變動金額達新台幣一千萬元之分析)

- (1) 流動資產增加：主要係因營業規模持續擴大，現金及約當現金、應收帳款及存貨等項目隨業務成長相應增加所致。
- (2) 不動產、廠房及設備增加：主要係因本公司積極擴充產能，本期購置土地及廠房，並增添設備等，以支應業務成長需求所致。
- (3) 使用權資產增加：主要係因本期新簽訂或續約辦公室及廠辦租賃合約，依 IFRS 16 規定認列使用權資產所致。
- (4) 無形資產增加：主要係因本期取得德國子公司 ATV 股權導致商譽增加所致。
- (5) 其他非流動資產減少：主要係因預付土地或廠房款項於本期完成資產取得後，轉列不動產、廠房及設備所致。
- (6) 資產總額增加：主要係因流動資產隨營業規模擴大增加，以及本期資本支出投入擴廠購地、增置設備，帶動非流動資產顯著成長所致。
- (7) 流動負債增加：主要係因營業規模擴大致應付帳款及應付費用增加，以及短期借款因應營運資金需求相應提升所致。
- (8) 非流動負債增加：主要係因本期新增長期借款以支應擴廠資本支出，以及依 IFRS 16 認列之租賃負債（非流動部分）增加所致。

- (9) 負債總額增加：主要係因流動負債及非流動負債均隨業務擴張及資本支出需求增加，惟負債增幅(+31.41%)低於資產增幅(+45.66%)，財務槓桿結構持續改善。
- (10) 資本公積增加：本主要係因本期可轉換公司債持有人執行轉換權利，轉換價格高於股票面額之溢價部分依規定轉列資本公積，致資本公積大幅增加。
- (11) 保留盈餘增加：主要係因本期經營績效良好，稅後純益貢獻保留盈餘成長，部分為本期現金股利發放所抵減。
- (12) 其他權益增加：本主要係因外幣換算調整數及備供出售金融資產(或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)未實現評價利益於本期增加所致。
- (13) 權益總額增加：主要係因可轉換公司債轉換為普通股致資本公積大幅增加，以及本期獲利帶動保留盈餘成長，股東權益結構顯著強化。

(二) 未來因應計畫：本公司財務狀況良好，對股東權益尚無重大影響。

二、財務績效

(一) 最近二年度經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入	13,371,181	10,171,861	3,199,320	31.45%
營業成本	5,943,372	4,610,891	1,332,481	28.90%
營業毛利	7,427,809	5,560,970	1,866,839	33.57%
營業費用	3,653,269	3,078,298	574,971	18.68%
營業淨利	3,774,540	2,482,672	1,291,868	52.04%
營業外收入及支出	69,728	312,044	-242,316	-77.65%
稅前淨利	3,844,268	2,794,716	1,049,552	37.55%
所得稅費用	665,738	490,471	175,267	35.73%
本期淨利	3,175,392	2,299,887	875,505	38.07%
本期其他綜合損益	166,538	93,297	73,241	78.50%
本期綜合損益總額	3,341,930	2,393,184	948,746	39.64%

(一) 增減比例變動分析說明：(變動比率達20%以上之分析)

- (1) 營業收入增加(+31.45%)：主要係因 AI 相關晶片需求持續強勁，本公司產品出貨量顯著成長，並帶動整體收入大幅提升。
- (2) 營業毛利增加(+33.57%)：主要係因營業收入成長幅度高於營業成本增幅，且產品組合持續優化，高毛利產品佔比提升，除整體毛利率微升外，毛利絕對金額也隨之增加。
- (3) 營業淨利增加(+52.04%)：主要係因營業收入及毛利大幅成長，營業費用增幅(+18.68%)相對收斂，除帶動營業收益率微升，營業利益絕對金額也有增加。
- (4) 營業外收入及支出減少(-77.65%)：主要係因上期有較大金額之匯兌利益或投資處分利益等非常態收益，本期上述非經常性項目減少，致營業外淨收益顯著縮減。
- (5) 本期其他綜合損益增加(+78.50%)：主要係因外幣換算調整數增加，以及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價利益擴大所致。

(二) 公司主要營業內容改變之原因，若營運政策、市場狀況、經濟環境或其他內外因素已發生或預期將發生重大之變動，其事實及影響變動與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

(三) 預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：請參閱本年報「壹、致股東報告書」及「伍、營運概況」之說明。

三、現金流量

(一) 最近二年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	114 年	113 年	變動金額	增(減)比例(%)
營業活動	2,037,993	2,096,925	-58,932	-2.81%
投資活動	-4,075,393	-1,343,097	-2,732,296	203.43%
籌資活動	3,760,565	357,469	3,403,096	952.00%
合 計	1,723,165	1,111,297	611,868	55.06%

增減比例變動分析說明:(增減變動比例達20%以上之分析)

(1) 投資活動現金流出增加(+203.43%): 主要係因本公司積極擴充產能, 本期大幅增加不動產、廠房及設備之資本支出, 包含購置土地、興建廠房及添購設備等, 致投資活動現金流出顯著擴大。

(2) 籌資活動現金流入增加(+952.00%): 主要係因本期有發行可轉換公司債, 籌資規模大幅提升, 使籌資活動現金流入增加。

(二) 最近二年度流動性分析：

年 度 項 目	114 年	113 年	增(減)比例(%)
現金流量比率	26.92	36.96	-10.04
現金流量允當比率	64.79	115.29	-50.50
現金再投資比率	2.88	10.82	-7.94

增減比例變動分析說明:(增減變動比例達20%以上之分析)

(1) 現金流量允當比率下降(115.29% → 64.79%): 本期現金流量允當比率較上期大幅下降50.50個百分點, 主要係因本期資本支出與存貨增加金額顯著高於營業現金流入, 致允當比率明顯下降, 反映本期係處於積極投資擴張階段。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年投資活 動暨融資活動現 金流入(出)量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
5,437,389	2,853,190	(2,118,000)	6,172,579	無	無

1. 本年度現金流量變動情形分析：
(1) 營業活動現金流量: 本公司營運持續成長, 營業活動有淨現金流入。

(2) 投資暨融資活動現金流量:受資本支出及發放現金股利影響,預計會呈淨現金流出。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司 114 年度重大資本支出主要為取得土地、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於半導體產業 AI 相關晶片需求持續強勁，本公司積極擴充產能，以支應業務成長所需。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司預計將投資一千四百萬歐元（約略相當新台幣五億元）取得德國半導體自動化量測儀器系統整合商 ATV Systems GmbH 100% 股權。預計透過此一收購案，將能提升旺矽在歐洲的精密度量測設備整合服務能力，優化客戶服務的完整性與即時性，進一步提升客戶滿意度與信任度。

本公司預計投入 2 仟 8 佰萬美元（約略相當於新台幣 8 億 7 仟萬元）收購射頻與毫米波量測技術領域具開創地位的 Focus Microwaves Inc. 100% 股權。此項收購將強化 MPI 在高頻測試與量測領域的佈局與能力，並進一步鞏固其持續成長的市場領導地位。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，經審慎評估後提報董事會決議討論。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

項 目	114 年度(仟元)	佔營收淨額%	佔稅後損益%
利息支出	71,919	0.54	2.26
淨兌換損失	-25,770	-0.19	-0.81

(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司114年度利息支出為新台幣71,919仟元，佔年度營收淨額0.54%及稅後損益2.26%。本公司會持續與銀行間維持良好關係以取得相對優惠之利率，並將隨時關注金融市場利率變化並適時調節資金部位，故預期未來利率之變化對本公司之整體營運尚無重大影響。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司114年度淨兌換損失為新台幣-25,770仟元，佔年度營收淨額-0.19%及稅後損益-0.81%。本公司因有外幣曝險部位，另受外銷產品至國外而有大量外幣應收帳款，然日常營運開銷因需以新台幣支應而有換匯需求，故匯率之變動將對本公司損益造成顯著影響，本公司將採取以下因應措施來規避匯兌風險：

(a) 與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，持續蒐集影響外匯市場之相關資訊，期能充分掌握匯率趨勢，及時因應匯率波動之影響。

(b) 除採自然避險方式，即以同幣別之銷貨收入支應採購支出規避匯率風險外，財會單位會密切關注外匯市場動態，並依全球總體經濟、匯率價格水準及未來資金需求等狀況，調整外幣部位，期以避免匯率波動對本公司之營運造成不利影響。

(c) 本公司訂有「從事衍生性金融商品交易處理程序」與「取得或處份資產處理程序」，相關外匯交易將依循此二處理程序辦理之。

(3) 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司與供應商關係良好，所需之相關原物料價格仍屬穩定，並目前無通貨膨脹之情形。未來仍將致力於各項成本的降低，並關注原物料價格的變化適時採取相對應之措施。本公司截至年報刊印日止並未有因通貨膨脹而對營運造成不利影響之情事，故通貨膨脹對本公司無重大影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

(1) 本公司並未從事高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性金融商品交易等行為。

(2) 子公司長洛國際股份有限公司於民國 113 年 12 月 2 日董事會決議通過資金貸與兄弟公司 MEGTAS CO., LTD.，決議貸與金額為 16,265 千元，合約期限為 113 年 12 月 12 日至 114 年 12 月 11 日；本公司於民國 114 年 8 月 13 日董事會決議通過資金貸予子公司 MEGTAS CO., LTD.，決議貸與金額為 45,060 千元，合約期限為 114 年 9 月 1 日至 115 年 8 月 31 日。

(三) 未來年度研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司研發計畫皆以符合客戶需求為主，在最近年度研發計畫中已成功開發多項產品與技術，未來將持續投入研發與創新，2026 年本公司預計將投入研發經費大約新台幣 5.7 億元，約佔營收的 4%，以因應市場需求的快速變化。而影響公司研發是否成功之主要因素在於人才的徵選、留存及訓練等，因應新的技術挑戰，確保技術領先之地位。

未來預估進行之研發計畫：

研發計畫名稱	研發成功之主要因素	目前進度	未來需再投入經費	預計量產時程
AI 晶片之混合待測物測試技術開發	電性與結構設計能力	設計開發中	1.5 億	2026 年
AI 晶片之高速訊號測試技術開發	電性與結構設計能力	設計開發中	1.5 億	2026 年
矽光子晶圓級雙面測試設備	精密機械設計與自動控制能力	設計開發中	1.5 億	2026 年
矽光子晶片級測試設備	晶片取放與自動控制能力	設計開發中	1.2 億	2026 年

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均依照主管機關法令規定辦理，本公司亦會隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情形，評估其對公司之影響，並於事前採取相對應之措施，以規避因政策及法律變動可能造成的不利影響。本公司截至年報刊印日止，並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受重大影響之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司為因應科技改變及產業變化，隨時掌握其市場變化，本公司透過參展、網路、產業、貿易及工會所舉辦的相關會議等方式獲取產業資訊訊息，並配合研發技術提昇及優異競爭優勢，擴展業務並精準掌握產業資訊之脈動，期以即時了解市場脈動並掌握獲利商機。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司企業形象良好，無此情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：因應未來營運及業務發展所需。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無此情形。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及年報刊印日止之處理情形：

因本公司離職員工於離職後至穎歲科技股份有限公司任職，涉嫌侵害本集團之營業秘密，經本集團提出刑事告訴，日前新竹地方檢察署起訴穎歲科技股份有限公司以及離職員工等人，該刑事案件目前由臺灣新竹地方法院審理中。

本集團對被告等人提起民事訴訟求償，已對上列當事人間侵害營業秘密有關財產權爭議等事件，本集團已向智慧財產法院及臺灣新竹地方法院聲請假扣押，累計已提存假扣押擔保金 80,550 千元，該營業秘密案經初步調查證據以及實施假扣押後，且因仍有相當多犯罪事證待刑事程序進行鑑識，該民事案件目前由臺灣高等法院及最高法院審理中。

本事件並不影響本集團之營運，且對本集團之財務亦無重大影響，另基於維護產業公平競爭以及捍衛智慧財產權之立場，本集團均已委任律師追訴相關被告之民事刑事法律責任。

截至民國 114 年 12 月 31 日及 113 年 12 月 31 日，本集團提存之假扣押擔保金金額均為 80,550 千元。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

(十四)行業特殊性的關鍵績效指標(Key Performance Indicator ,KPI):

本公司探針卡營運中心行業特性的關鍵績效指標為先進式探針卡技術之研發及其佔探針卡營收的比率，比率越高越好。以下為最近兩年度先進式探針卡佔探針卡營收比率一覽表：

產品技術項目	113 年	114 年
懸臂式探針卡	29%	18%
先進式探針卡	71%	82%

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

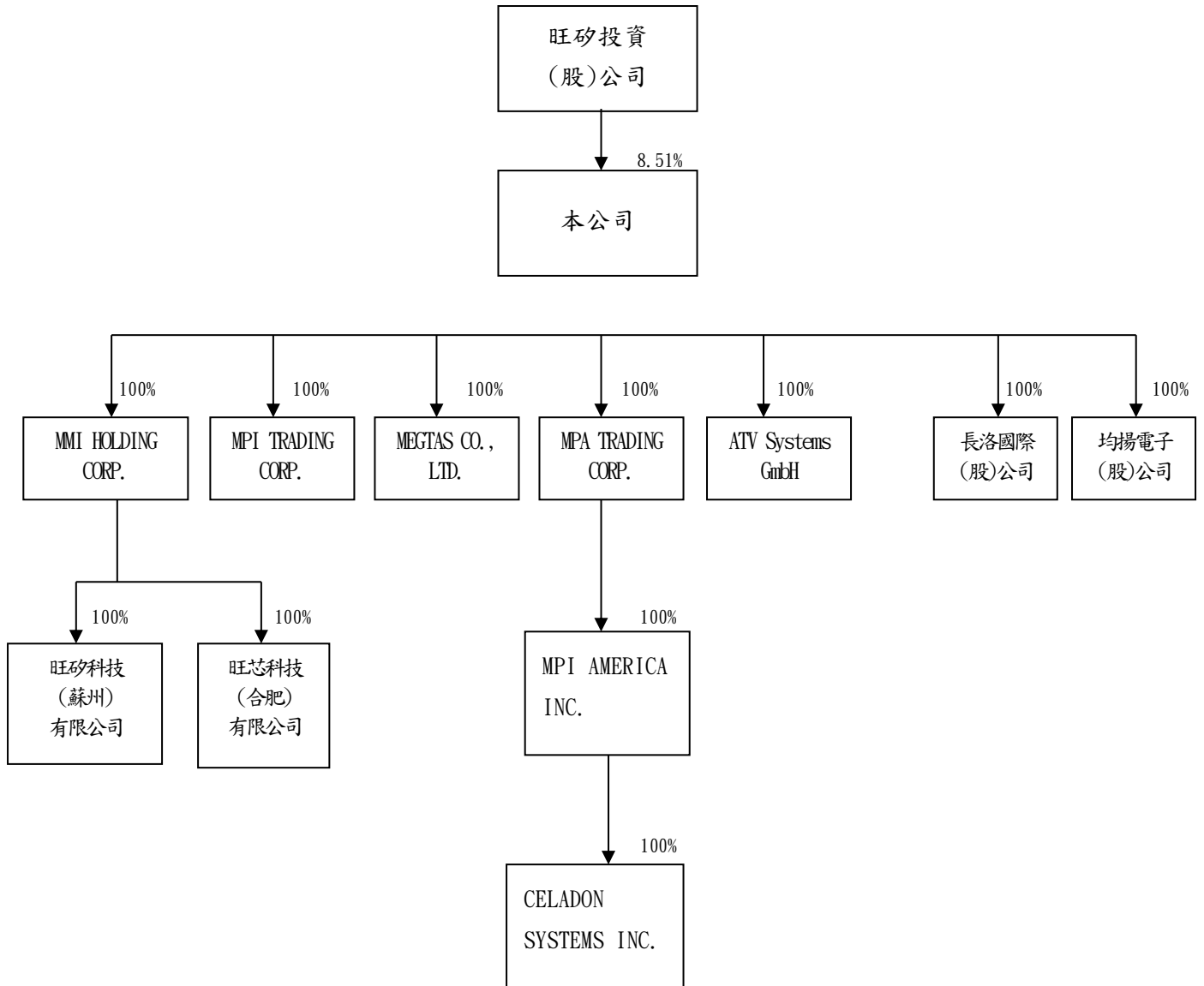
一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業概況

(1) 關係企業組織概況

(一) 關係企業組織圖

114 年 12 月 31 日



(二)依公司法第 369 條之 2 規定之從屬公司，均編入關係企業合併財務報表。

(三)依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係之公司：無。

二、各關係企業基本資料

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
旺矽投資股份有限公司	89.12.29	竹北市十興里 36 鄰嘉仁街 98 巷 8 號 3 樓	1,107	一般投資業
長洛國際股份有限公司	83.03.01	新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 988 號 2 樓	50,000	半導體設備代理廠商
MPI TRADING CORP.	89.12.22	Offshore Chambers, P.O.BOX 217, APIA, SAMOA	1,000 美元	從事經營 Probe Card 探針卡業務
MMI HOLDING CO., LTD.	90.08.07	Offshore Chambers, P.O.BOX 217, APIA, SAMOA	15,667,987 美元	控股
MEGTAS CO., LTD.	99.09.01	134 Gunseo-ri, Jikson-eub, Seobuk-gu, Cheonan, Chungnam, 331-811, Korea	2,500,000,000 韓元	半導體裝備及產業機械零附件製造與加工販賣商、陶器及電子零附件製造與販賣商
均揚電子股份有限公司	95.03.31	新竹縣竹北市興安里 36 鄰嘉仁街 98 巷 8 號	15,500	高頻晶圓量測之探針製造商
MPA TRADING CORP.	106.04.12	Vistra (Anguilla) Limited of Vistra Corporate Services Centre, Albert Lake Drive, The Valley, Anguilla, British West Indies.	11,450,000 美元	控股
ATV Systems GmbH	89.4.27	Heilbronner Str. 17, 01189 Dresden, Germany	25,000 歐元	設計、開發和製造先進的電子測試解決方案、電子元件封裝和晶圓級的功能測試設備、工業自動化的軟硬體開發、電子和半導體製造設備經營、諮詢和培訓服務
旺芯科技(合肥)有限公司(註)	103.01.10	安徽省合肥市新站區銅陵北路與西淝河路交口科創大廈 A 棟 6 層 604 室	13,400,000 美元	半導體器件專用設備製造、銷售；電子測量儀器製造、銷售；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備製造、銷售；儀器儀表修理、銷售；工業自動控制系統裝置銷售；光學儀器銷售、製造；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電子元器件零售；

				租賃服務(不含許可類租賃服務); 軟件開發; 技術服務、開發、諮詢、交流、轉讓及推廣; 貿易經紀; 互聯網銷售; 貨物及技術進出口。
旺矽科技(蘇州)有限公司	106.07.11	蘇州工業園區春輝路13號	2,000,000 美元	研發、生產 LED 半導體照明芯片、計算機零部件、LED 製程設備、新型電子元器件; 電子材料、電子元器件、電子產品、LED 製程設備、機械設備及零部件的採購、批發、佣金代理及進出口業務。
MPI AMERICA INC.	106.03.29	2360 QUME DRIVE, SUITE C, SAN JOSE, CA	11,400,000 美元	從事探針卡及半自動點測機買賣
CELADON SYSTEMS INC.	85.05.17	13795 FRONTIER CT BURNSVILLE, MINNESOTA 55337, USA	2,255,106 美元	探針卡及測試系統、高性能電纜之產銷

註：琉明光電(常州)有限公司因營運需求，於民國 114 年 5 月 9 日經董事會通過變更公司名稱及營業地址，此項投資案業經經濟部投資審議委員會核准在案。

三、推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

四、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：投資業；半導體設備及零附件之生產、測試、研發、製造及買賣；半導體設備代理；貿易業務；電子資訊供應服務；電子器材、電子材料批發零售及電子零組件製造等。

五、各關係企業董事、監察人及總經理資料：

114 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱(註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)	
			股數 (出資額)	持股比例 (出資比例)
旺矽投資(股)公司	董事長	葛長林	49,636 股	44.83%
	董事	李篤誠	30,089 股	27.17%
	董事	陳四桂	10,029 股	9.06%
	監察人	郭遠明	2,966 股	2.68%
長洛國際(股)公司	出資者名稱	旺矽科技(股)公司	5,000,000 股	100.00%
	董事長	葛長林		
	董事	陳四桂		

	董事 監察人 總經理	郭遠明 饒雲珍 詹朝男		
MPI TRADING CORP.	出資者名稱 負責人	旺矽科技(股)公司 葛長林	1,000 股	100.00%
MMI HOLDING CO., LTD.	出資者名稱 負責人	旺矽科技(股)公司 葛長林	15,667,987 股	100.00%
MEGTAS CO., LTD.	出資者名稱 董事長 董事 董事 董事 監察人	旺矽科技(股)公司 代表人： HUAN-SHENG LIN HUAN-SHENG LIN DU-HWA HWANG JUNG-JAE CHEUN SHENG-YI CHEN	500,000 股	100.00%
均揚電子(股)公司	出資者名稱 董事長 董事 董事 監察人	旺矽科技(股)公司 代表人： 郭遠明 陳四桂 劉永欽 饒雲珍	1,550,000 股	100.00%
MPA TRADING CORP.	出資者名稱 負責人	旺矽科技(股)公司 葛長林	11,450,000 股	100.00%
ATV Systems GmbH	出資者名稱 負責人	旺矽科技(股)公司 葛長林	-	100.00%
旺芯科技(合肥)有限公司	出資者名稱 負責人	MMI HOLDING CO., LTD. 郭遠明	13,400,000 美元	100.00%
旺矽科技(蘇州)有限公司	出資者名稱 負責人	MMI HOLDING CO., LTD. 詹雲富	2,000,000 美元	100.00%
MPI AMERICA INC.	出資者名稱 負責人	MPA TRADING CORP. Robert S. Carter	6,300,000 股	100.00%
CELADON SYSTEMS INC.	出資者名稱 負責人	MPI AMERICA INC. Karen R. Armendariz	1,000 股	100.00%

註 1. 關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2. 被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3. 董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

註 4. 以上各關係企業未設總經理者，以各該企業之董事長(或負責人、董事)兼任之。

貳、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果：

114年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
長洛國際 (股)公司	50,000	1,800,692	1,471,734	328,958	1,092,070	104,075	96,656	19.33
MPI TRADING CORP.	32	57,609	—	57,609	—	(41)	980	980
MMI HOLDING CO., LTD.	488,345	990,216	—	990,216	77,840	77,760	76,921	4.81
MEGTAS CO., LTD.	66,509	35,826	22,607	13,219	44,334	(6,713)	(7,498)	(15.00)
均揚電子 (股)公司	15,500	733	95	638	—	(320)	(90)	(0.06)
MPA TRADING CORP.	321,352	135,537	—	135,537	8	(22,522)	(22,573)	(1.97)
ATV Systems GmbH	873	332,138	92,135	240,003	54,068	(2,218)	286	—
旺芯科技(合 肥)有限公司	417,021	477,376	3,430	473,946	25,392	(19,350)	(51,317)	—
旺矽科技(蘇 州)有限公司	60,180	2,214,731	1,711,596	503,135	2,879,332	125,855	129,013	—
MPI AMERICA INC.	319,837	1,345,785	1,211,456	134,329	2,048,457	(34,953)	(22,465)	(3.57)
CELADON SYSTEMS INC.	62,793	220,128	47,425	172,703	292,396	15,392	17,310	17,310

註 1. 所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註 2. 關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

註 3. 以上關係企業財務報表業經母公司會計師查核簽證。

註 4. 若被投資公司為有限公司，其每股盈餘不適用。

註 5. 報表日兌換率：人民幣：台幣=1：4.49543；加權平均匯率：1：4.48874

新台幣：美金=1：31.42575；加權平均匯率：1：32.10950

新台幣：韓元=1：0.02201；加權平均匯率：1：0.02225

新台幣：歐元=1：36.87588；加權平均匯率：1：35.50807

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：旺矽科技股份有限公司



董事長：葛長林



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 一 日

(三) 關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

旺矽科技股份有限公司



董事長：葛長林

